







1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-091704

(43)Date of publication of application: 28.03.2003

(51)Int.CI.

G06K 19/07 B42D 15/10

(21)Application number : 2001-388727

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

21,12,2001

(72)Inventor: MIZUSHIMA EIGA

TSUNODA MOTOYASU HATANO TOMIHISA KATAYAMA KUNIHIRO

TANAKA NORIO

TSUNEHIRO TAKASHI

KIMURA KOICHI

(30)Priority

Priority number : 2001207212

Priority date: 09.07.2001

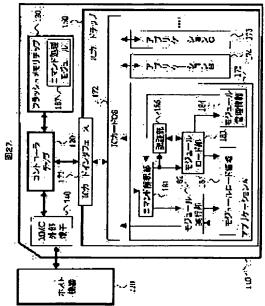
Priority country: JP

(54) STORAGE UNIT WITH NON-VOLATILE MEMORY AND INFORMATION PROCESSING DEVICE WITH FREELY DETACHABLE STORAGE UNIT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make an IC execute a large amount of processing even when the storage capacity in the IC (for example, ROM and EERROM) is small.

SOLUTION: This storage unit is provided with a flash memory chip 130, an IC card chip 150 capable of executing the security processing (encryption, decryption and the like), and a controller chip 12 for controlling the access to the flash memory chip and the IC card chip in accordance with the request from a host 220, a program of an IC card necessary for the security processing and a part of the data are stored in the flash memory chip, or the IC card chip requests the data processing utilizing the flash memory chip and the host equipment.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.05.2004

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-91704

(P2003-91704A)

(43)公開日 平成15年3月28日(2003.3.28)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I	テーマコード(参考)
G06K 19/0	7	B 4 2 D 15/10	521 2C005
B42D 15/1	521	G06K 19/00	N 5B035

審査請求 未請求 請求項の数18 OL (全 39 頁)

(21)出願番号	特顧2001-388727(P2001-388727)	(71)出顧人	000005108
			株式会社日立製作所
(22)出顧日	平成13年12月21日(2001.12.21)		東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地
		(72)発明者	水島 永雅
(31)優先権主張番号	特願2001-207212 (P2001-207212)		神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株
(32)優先日	平成13年7月9日(2001.7.9)		式会社日立製作所システム開発研究所内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	角田 元泰
			神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株
	·		式会社日立製作所システム開発研究所内
		(74)代理人	100075096
			弁理士 作田 康夫
			•

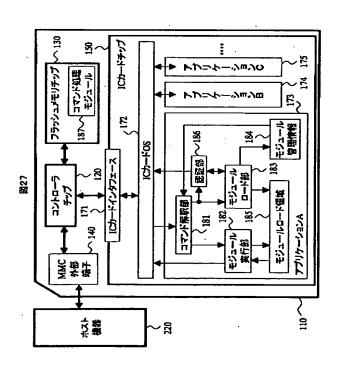
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 不揮発性メモリを備えた記憶装置及びその記憶装置が着脱自在な情報処理装置

(57) 【要約】

【課題】本発明は、IC内の記憶容量(例えば、ROMやEERROM、RAM)が小さい場合にも、ICに多くの処理を実行させる。

【解決手段】本発明は、フラッシュメモリチップ130と、セキュリティ処理(暗号化や復号化等)を実行可能なICカードチップ150と、ホスト220からの要求に応じてフラッシュメモリチップ及びICカードチップへのアクセスを制御するためのコントローラチップ120とを備え、セキュリティ処理に必要なICカードのプログラムやデータの一部をフラッシュメモリチップに格納し、又は、ICカードチップがフラッシュメモリチップやホスト機器を利用したデータ処理を要求する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】ホスト機器からのデータを記憶するための データ領域を有する不揮発性メモリと、セキュリティ処 理を実行するためのICと、前記不揮発性メモリ及び前 記ICへのアクセスを制御するためのコントローラとを 備えた記憶装置において、

前記不揮発性メモリは、前記アプリケーションプログラ ムの一部を格納するための管理領域前記ICは、前記セ キュリティ処理を前記ICに実行させるためのアプリケ ーションプログラムの他部を格納するための格納領域を 有する記憶装置。

【請求項2】前記ICは、前記アプリケーションプログ ラムの一部を暗号化し、

前記コントローラは、暗号化された前記アプリケーショ ンプログラムの一部を、前記不揮発性メモリに書き込む 請求項1に記載の記憶装置。

【請求項3】前記コントローラは、前記ホスト機器から のコマンドに応じて、前記不揮発性メモリから前記暗号 化されたアプリケーションプログラムの一部を読み出 し、前記ICへ転送し、

前記ICは、前記暗号化されたアプリケーションプログ ラムの一部を受信し、復号化する請求項2に記載の記憶 装置。

【請求項4】前記ICは、中央処理装置と、前記ICの オフィスシステムプログラムを格納するための第1のR OMと、前記格納領域を有する電気的に書き換え可能な 第2のROMと、前記アプリケーションプログラム及び 前記オフィスシステムプログラムを格納するためのRA Mとを有する請求項1に記載の記憶装置。

【請求項5】前記セキュリティ処理は、暗号化又は復号 化処理を含む請求項1に記載の記憶装置。

【請求項6】データを記憶するためのデータ領域を有す る不揮発性メモリとセキュリティ処理を実行するための I Cと前記不揮発性メモリ及び前記 I Cへのアクセスを 制御するためのコントローラとを有し且つ着脱自在な記 億装置と、前記セキュリティ処理を前記記憶装置へ要求 するためのCPUと、ネットワークと通信するための通 信装置とを備えた情報処理装置において、

前記不揮発性メモリは、前記アプリケーションプログラ ムの一部を格納するための管理領域前記ICは、前記セ キュリティ処理を前記 I Cに実行させるためのアプリケ ーションプログラムの他部を格納するための格納領域を 有する情報処理装置。

【請求項7】前記通信装置は、ネットワークを通じて、 銀行取引を実行するための銀行取引サーバとクレジット 決済を実行するためのクレジット決済サーバとコンテン ツ配信を実行するためのコンテンツ配信サーバの少なく とも1つと通信可能である請求項6に記載の情報処理装 置。

【請求項8】データ領域を有する不揮発性メモリと、前

記不揮発性メモリに比較して耐タンパ性の高いICと、 前記不揮発性メモリ及び前記ICへのアクセスを制御す るためのコントローラとを備えた記憶装置において、

前記ICは、銀行取引を処理するための第1のアプリケ ーションプログラムと、クレジット決済を処理するため の第2のアプリケーションプログラムと、配信コンテン ツを処理するための第3のアプリケーションプログラム とを有し、ホスト機器からのコマンドに応じて、前記第 1のアプリケーションプログラム又は前記第2のアプリ 10 ケーションプログラム又は前記第3のアプリケーション プログラムを選択し、実行する記憶装置。

【請求項9】前記ICは、前記第1のアプリケーション プログラムを実行するための第1の10と、前記第2の アプリケーションプログラムを実行するための第2のⅠ 15 Cと、前記第3のアプリケーションプログラムを実行す るための第3のICとを有する請求項8に記載の記憶装

【請求項10】前記不揮発性メモリは、前記ホスト機器 からのデータを格納するためのデータ領域と、前記第1 20 のアプリケーションプログラムの一部と前記第2のアプ リケーションプログラの一部と前記第3のアプリケーシ ョンプログラムの一部との少なくとも1つを格納するた めの管理領域を有する請求項8に記載の記憶装置。

【請求項11】不揮発性メモリと前記不揮発性メモリに 25 比較して耐タンパ性の高い I Cと前記不揮発性メモリ及 び前記ICへのアクセスを制御するためのコントローラ と有し且つ着脱自在な記憶装置と、前記記憶装置へコマ ンドを発行するためのCPUと、ネットワームと通信す るための通信装置とを備えた情報処理装置において、

前記ICは、銀行取引を処理するための第1のアプリケ 30 ーションプログラムと、クレジット決済を処理するため の第2のアプリケーションプログラムと、配信コンテン ツを処理するための第3のアプリケーションプログラム とを有し、前記CPUからの前記コマンドに応じて、前 35 記第1のアプリケーションプログラム又は前記第2のア プリケーションプログラム又は前記第3のアプリケーシ ョンプログラムを選択し、実行する情報処理装置。

【請求項12】不揮発性メモリと、ICと、前記不揮発 性メモリ及び前記ICへのアクセスを制御するためのコ ントローラと、前記不揮発性メモリと前記ICと前記コ 40 ントローラとによって共有化され且つホスト機器と接続 するためのインタフェースを備えた記憶装置において、 前記コントローラは、前記ホスト機器からの第1のコマ ンドを受信し、前記ホスト機器からの第1のコマンドに 45 応じて、前記 I Cが解釈可能な第2のコマンドを作成 し、前記ICへ送信する記憶装置。

【請求項13】不揮発性メモリと、処理の実行に必要な ワームメモリを有するICと、前記不揮発性メモリ及び 前記ICへのアクセスを制御するためのコントローラと を備えた記憶装置において、

05

前記コントローラは、前記ICが解釈可能なコマンドを 発行し、

前記ICは、前記コマンドによって処理対象とされたデータのデータ量と前記ワームメモリの空き容量とを比較し、その比較結果に応じて前記コントローラへのレスポンスを決定し、前記コントローラへ送信する記憶装置。

【請求項14】前記ICは、前記データ量が前記空き容量より大きい場合に、前記コントローラへの処理要求を含む前記レスポンスを決定する請求項13に記載の記憶装置。

【請求項15】前記レスポンスは、前記ICと前記コントローラとの間で予め定義されたステータスワードを含む請求項14に記載の記憶装置。

【請求項16】前記コントローラは、前記レスポンスを受信し、前記レスポンスによって要求された処理を実行し、その処理結果を前記ICへ送信する請求項14に記載の記憶装置。

【請求項17】前記ICは、前記データ量が前記空き容量以下の場合に、前記データに対し前記コマンドによって要求された処理を実行し、その処理結果を前記コントローラへ送信する請求項14に記載の記憶装置。

【請求項18】不揮発性メモリとICと前記不揮発性メモリ及び前記ICへのアクセスを制御するためのコントローラとを有し且つ着脱自在な記憶装置と、CPUと、ネットワームと通信するための通信装置とを備えた情報処理装置において、

前記コントローラは、前記ICが解釈可能なコマンドを発行し、

前記ICは、前記コマンドによって処理対象とされたデータのデータ量と前記ワームメモリの空き容量とを比較し、その比較結果に応じて前記コントローラへのレスポンスを決定し、前記コントローラへ送信する情報処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はセキュリティ機能を搭載した記憶装置及びその記憶装置が挿入可能なホスト機器及びその記憶装置が挿入されたホスト機器に係り、不揮発性のフラッシュメモリチップ、IC(Integrated circuit;集積回路)カードチップ及びコントローラチップとを有するメモリカード及びそのメモリカードが挿入可能な(着脱自在な)情報処理装置及びそのメモリカードが挿入された情報処理装置に関する。

[0002]

【従来の技術】I Cカードは、プラスチックカード基板中にIC(集積回路)チップを埋め込んだものであり、その表面にI Cチップの外部端子を持つ。I Cチップの外部端子には電源端子、クロック端子、データ入出力端子などがある。I Cチップは、接続装置が外部端子から電源や駆動クロックを直接供給することによって動作す

る。ICカードは外部端子を通して端末機などの接続装置との間で電気信号を送受信することにより、接続装置と情報交換をおこなう。情報交換の結果として、ICカードは計算結果や記憶情報の送出、記憶情報の変更をおこなう。ICカードは、これらの動作仕様に基づいて、機密データ保護や個人認証などのセキュリティ処理を実行する機能を持つことができる。ICカードは、クレジット決済やバンキングなど機密情報のセキュリティが必要とされるシステムにおいて、個人識別のためのユーザ10 デバイスとして利用されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】セキュリティシステムにおいて利用されるユーザ識別装置は、秘密情報を用いて演算を行う際に、その秘密情報あるいはその秘密情報を外にもらさないように設計される必要がある。すなわち、耐タンパ性を持つことが必要とされる。また、ユーザ識別装置はユーザにとって利便性が高いことが必要である。例えば、1台の装置でより多くのセキュリティシステムに対応できるしくみを持つこと、さらに、より大きなサイズのデータを処理する能力を持つことである。

【0004】本発明の目的は、ICが実行するためのプログラムやデータ、ICを管理するための情報をIC外部の不揮発性メモリに保持するため、IC内の記憶容量が小さい場合にも、ICが多くの処理を実行できる記憶装置及び情報処理装置を提供することである。

【0005】本発明の目的は、ICが実行する処理の一部をIC外部のコントローラが実行するため、IC内の記憶容量(例えば、RAM)が小さい場合にも、ICが30多くの処理を実行できる記憶装置及び情報処理装置を提供することである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、不揮発性メモリが、ICに実行させるためのアプリケーションプログ35 ラムの一部を格納する。

【0007】本発明は、ICが、銀行取引を処理するための第1のアプリケーションプログラムと、クレジット 決済を処理するための第2のアプリケーションプログラムと、配信コンテンツを処理するための第3のアプリケ ・ションプログラムとを有し、ホスト機器からのコマンドに応じて、第1のアプリケーションプログラム又は第2のアプリケーションプログラム又は第3のアプリケーションプログラムを選択し、実行する。

【0008】本発明は、コントローラが、ホスト機器か 45 らの第1のコマンドに応じて、ICが解釈可能な第2の コマンドを作成し、ICへ送信する。

【0009】本発明は、1Cが、コントローラからのコマンドによって処理対象とされたデータのデータ量と1 C内のワームメモリの空き容量とを比較し、その比較結果に応じてコントローラへのレスポンスを決定し、コン トローラへ送信する。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態につい て説明する。

【0011】図22は、本発明を適用したMultiM ediaCard (MultiMediaCardはI nfineonTechnologiesAGの登録商 標である。以下、「MMC」と略記する。) の内部構成 図を簡単に表したものである。MMC110は、Mul t i Media Card 仕様に準拠するのが好ましい。 MMC110は、外部に接続したホスト機器220がM ultiMediaCard仕様に準拠したメモリカー ドコマンドを発行することによって、機密データ保護や 個人認証などに必要な暗号演算をおこなうセキュリティ 処理機能を持つ。ホスト機器220は、例えば、携帯電 話、携帯情報端末(PDA)、パーソナルコンピュー タ、音楽再生(及び録音)装置、カメラ、ビデオカメ ラ、自動預金預払器、街角端末、決済端末等が該当す る。MMC110は、MMC外部端子140、コントロ ーラチップ120、フラッシュメモリチップ130、1 Cカードチップ150を持つ。フラッシュメモリチップ 130は、不揮発性の半導体メモリを記憶媒体とするメ モリチップであり、フラッシュメモリコマンドによりデ ータの読み書きができる。MMC外部端子140は7つ の端子から構成され、外部のホスト機器220と情報交 換するために、電源供給端子、クロック入力端子、コマ ンド入出力端子、データ入出力端子、グランド端子を含 む。コントローラチップ120は、MMC110内部の 他の構成要素(MMC外部端子140、フラッシュメモ リチップ130、ICカードチップ150) と接続され ており、これらを制御するマイコンチップである。IC カードチップ150は、ICカードのプラスチック基板 中に埋め込むためのマイコンチップであり、その外部端 子、電気信号プロトコル、コマンドは ISO/IEC7 816規格に準拠している。 I Cカードチップ150の 外部端子には、電源供給端子、クロック入力端子、リセ ット入力端子、I/〇入出力端子、グランド端子があ る。コントローラチップ120は、1Cカードチップ1 50の外部端子からICカードチップ150にICカー ドコマンドを発行することによって、外部のホスト機器 220から要求されたセキュリティ処理に必要な演算を おこなう。

【0012】図26は、本発明のICカードチップの内部構成を示す図である。ICカードチップ150は、演算処理を行うためのCPU(マイコン)158と、データ(プログラムを含む。)を記憶するためのROM(Read Only Memory)159とRAM(Random Access Memory)160とEEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)162と、

暗号/復号に関する処理を行うための暗号コプロセッサ 163と、外部とデータを送受信するためのシリアルインターフェース161とを備え、それらは、バス164によって接続される。そして、その暗号コプロセッサ10563によって、ホスト機器220からのコマンドに応じて、ICカードチップ150自らが、セキュリティ処理を実行することが可能である。尚、暗号コプロセッサ163(ハードウェア)の替わりに、プログラム(ソフトウェア)に従ってCPU158がセキュリティ処理を実10行してもよい。

【0013】一方、フラッシュメモリチップ130には、記憶素子を備えるが、マイコンは存在しない。
【0014】セキュリティ処理は、例えば、ICカードチップ150内の記憶領域にデータが書き込まれるとき、又は、ICカードチップ150内の記憶領域からデータが読み出されるときに実行される。ICカードチップ150のEEPROMの記憶容量は、フラッシュメモリチップ130の記憶容量より小さい。但し、ICカードチップ150のEEPROMの記憶容量は、フラッシュメモリチップ130の記憶容量と同じでもよいし、大きくてもよい。

【0015】ICカードチップ150には、セキュリテ ィ評価基準の国際標準であるISO/IEC15408 の評価・認証機関によって認証済みである製品を利用す 25 る。一般に、セキュリティ処理をおこなう機能を持つ I Cカードを実際の電子決済サービスなどで利用する場 合、そのICカードはISO/IEC15408の評価 ・認証機関による評価と認定を受ける必要がある。MM Cにセキュリティ処理をおこなう機能を追加することに 30 よってMMC110を実現し、それを実際の電子決済サ ービスなどで利用する場合、MMC110も同様にIS 〇/IEC15408の評価・認証機関による評価と認 定を受ける必要がある。本発明によれば、MMC110 は、評価・認証機関によって認証済みのICカードチッ 35 プ150を内蔵し、そのICカードチップ150を利用 してセキュリティ処理をおこなう構造を持つことによ り、セキュリティ処理機能を得る。したがって、MMC 110はISO/IEC15408に基づくセキュリテ ィ評価基準を容易に満足することができ、MMCにセキ ュリティ処理機能を追加するための開発期間を短縮する ことができる。

【0016】MMC110は、MultiMediaCard仕様に準拠した外部インタフェースを持つのが好ましい。MMC110は、一種類の外部インタフェース を通じて、標準メモリカードコマンド (フラッシュメモリチップ130ヘアクセスするためのコマンド) に加えて、セキュリティ処理を実行するコマンドを受け付ける必要がある。コントローラチップ120は、MMC110が受信したコマンドが標準メモリカードコマンドであるか、セキュリティ処理を実行するコマンドであるかに

よって、アクセスすべきチップを選択し、コマンド処理を分配する機能を持つ。本発明によれば、標準メモリカードコマンドを受信したならば、フラッシュメモリチップ130を選択し、これにフラッシュメモリコマンドを発行してホストデータを読み書きできる。また、セキュリティ処理を実行するコマンドを受信したならば、1Cカードチップ150を選択し、これにICカードコマンドを発行してセキュリティ処理を実行することができる。

【0017】ICカードチップ150の外部端子は、グランド端子を除いて、電源供給端子、クロック入力端子、リセット入力端子、1/O入出力端子がコントローラチップ120に接続されている。

【0018】コントローラチップ120は、電源供給端子、クロック入力端子を通して、ICカードチップ150への電源供給、クロック供給を制御する。本発明によれば、ホスト機器220からセキュリティ処理を要求されないときには、ICカードチップ150への電源供給やクロック供給を停止させることができ、MMC110の電力消費を削減することができる。

【0019】電源供給されていない I Cカードチップ 1 50を、ICカードコマンドを受信できる状態にするに は、まず、ICカードチップ150に電源供給を開始 し、リセット処理を施すことが必要である。コントロー ラチップ120は、MMC110がホスト機器220か らセキュリティ処理を実行するコマンドを受信したのを 契機に、電源供給端子を通して I Cカードチップ 1 5 0 への電源供給を開始する機能を持つ。また、コントロー ラチップ120は、MMC110がホスト機器220か らセキュリティ処理を実行するコマンドを受信したのを 契機に、リセット入力端子を通して I Cカードチップ 1 50のリセット処理をおこなう機能を持つ。本発明によ れば、コントローラチップ120は、セキュリティ処理 を実行するコマンドを受信するまで I Cカードチップ 1 50への電源供給を停止させておくことができる。した がって、MMC110の電力消費を削減することができ る。

【0020】コントローラチップ120は、ICカードチップ150のクロック入力端子を通してICカードチップ150に供給するクロック信号をMMC110内部 40で発生し、その周波数、供給開始タイミング、供給停止タイミングを制御する機能を持つ。本発明によれば、MMC外部端子140のクロック入力端子のクロック信号と無関係にすることができるため、ホスト機器220によるタイミング解析、電力差分解析、故障利用解析と呼 45ばれる攻撃法に対してセキュリティが向上する。

【0021】図21は、フラッシュメモリチップ130の詳細な内部構成を表している。フラッシュメモリチップ130は、ホストデータ領域2115と管理領域21 10とを含む。ホストデータ領域2115は、セクタ単

位に論理アドレスがマッピングされている領域であり、 ホスト機器220が論理アドレスを指定してデータを読 み書きできる領域である。ホストデータ領域2115 は、ユーザファイル領域2130とセキュリティ処理ア プリケーション領域2120とを含む。ユーザファイル 05 領域2130は、ユーザが自由にファイルデータを読み 書きできる領域である。セキュリティ処理アプリケーシ ョン領域2120は、ホスト機器220がセキュリティ 処理アプリケーションに必要なデータを格納する領域で 10 あり、ユーザが不正にアクセスしないように、ホスト機 器220のセキュリティ処理アプリケーションが論理的 にユーザアクセス制限をかける。ここに格納するデータ としては、ホスト機器220のアプリケーションプログ ラム、そのアプリケーション専用のデータ、セキュリテ 15 ィ処理に使用される証明書など(例えば、電子決済アプ リケーションプログラム、電子決済ログ情報、電子決済 サービス証明書など)が可能である。本発明によれば、 MMC110が、ホスト機器220がセキュリティ処理 をおこなう上で使用するデータをホスト機器220の代 20 わりに格納するため、ホスト機器220にとって利便性 が向上する。

【0022】一方、管理領域2110は、コントローラチップ120がICカードチップ150を管理するための情報を格納する領域である。管理領域2110は、I 25 Cカード制御パラメータ領域2111、ICカード環境設定情報領域2112、CLK2設定情報領域2113、セキュリティ処理バッファ領域2114、セキュリティ処理ステータス領域2116とを含む。2111~2116の領域の詳細な使用法については後述する。

【0023】コントローラチップ120は、フラッシュ メモリチップ130の管理領域2110のセキュリティ 処理パッファ領域2114を、ICカードチップ150 でセキュリティ処理を実行する際のメインメモリまたは バッファメモリとして利用する。ホスト機器220がセ 35 キュリティ処理を実行するコマンドによりMMC110 にアクセスした際に、MMC110がホスト機器220 からICカードチップ150に一度に送信できないほど の大きなサイズのセキュリティ関連データを受信したな らば、コントローラチップ120はフラッシュメモリチ ップ130へのアクセスを選択し、そのデータを十分な 容量を持つセキュリティ処理バッファ領域2114に一 時的に格納する。 I Cカードチップ150に一度に送信 できないほどのサイズは、ICカードコマンドの許容デ ータサイズ (例えば、255バイト又は256パイト) 45 を超えるサイズである。そして、コントローラチップ1 20はそれを1Cカードチップ150に送信できるサイ

ズのデータに分割し、分割データをフラッシュメモリチ

ップ130から読み出し、段階的に1Cカードチップ1

50に送信する。つまり、分割されたデータの読み出

50 し、售き込みを繰り返す。本発明によれば、ホスト機器

220にとって、大きなサイズのセキュリティ関連データを扱うことができるので、セキュリティ処理の利便性が向上する。

【0024】上記のセキュリティ処理バッファ領域2114を含む管理領域2110は、ホスト機器220が不正にアクセスしてセキュリティ処理を解析することができないように、コントローラチップ120により物理的にホストアクセス制限がかけられている。つまり、管理領域2110はホスト機器220が直接データを読み書きできない。本発明によれば、ホスト機器220がセキュリティ処理バッファ領域2114の内容を自由に読み出したり改ざんすることができないため、セキュリティ処理の信頼性や安全性が向上する。

【0025】図23は、MMC110を利用したセキュ リティ処理の一例として、コンテンツ配信のセキュリテ ィ処理を表したものである。コンテンツプロバイダ23 10は、MMC110を所有するユーザにコンテンツ2 314を販売する業者である。ホスト機器220は、こ の例では、コンテンツプロバイダ2310とネットワー クなどを介して接続することができる端末機である。ユ ーザはMMC110をホスト機器220に接続してコン テンツ2314を購入する。以下、その手順を説明す る。まず、ホスト機器220はMMC110に、フラッ シュメモリチップ130に格納されたユーザ証明書23 21を読み出すコマンドを発行する。MMC110のコ ントローラチップ120は、フラッシュメモリチップ1 30のセキュリティ処理アプリケーション領域2120 に格納されたユーザ証明書2321を読み出し、それを ホスト機器220に送信する。そして、ホスト機器22 0 はそれをコンテンツプロバイダ2310に送信する。 コンテンツプロバイダ2310はユーザ証明書2321 につけられたデジタル署名を検証する(2311)。検 証が成功したならば、乱数発生器によりセッション鍵を 生成し(2312)、それをユーザ証明書2321から 抽出したユーザ公開鍵によって暗号化する(231 3)。さらに、コンテンツ2314をそのセッション鍵・ によって暗号化する(2315)。コンテンツプロバイ ダ2310はステップ2313の結果をホスト機器22 0に送信する。ホスト機器220は、ステップ2313 の結果をユーザ秘密鍵2322によって復号するセキュ リティ処理を要求するコマンドを、MMC110に発行 する。コントローラチップ120は、ステップ2313 の結果をユーザ秘密鍵2322によって復号するICカ ードコマンドを、ICカードチップ150に発行する。 ICカードチップ150は、ユーザ秘密鍵2322によ ってステップ2313の結果を復号して、セッション鍵 を取得する(2323)。ホスト機器220は、この復 号処理が成功したかを示す情報を出力させるコマンドを MMC110に発行する。コントローラチップ120 は、1 Cカードチップ150の出力する復号結果(復号

処理が成功したかを示す I Cカードレスポンス) をもと にしてホスト機器220の求める情報を構築する。そし て、MMC110はその情報をホスト機器220に送信 する。次に、コンテンツプロバイダ2310は、ステッ 05 プ2315の結果を、ホスト機器220に送信する。ホ スト機器220は、ステップ2313の結果をセッショ ン鍵(ステップ2323によって取得した鍵)によって 復号するセキュリティ処理を要求するコマンドを、MM C110に発行する。コントローラチップ120は、ス 10 テップ2315の結果をセッション鍵によって復号する ICカードコマンドを、ICカードチップ150に発行 する。ICカードチップ150は、セッション鍵によっ てステップ2315の結果を復号して、コンテンツ23 14を復元する(2324)。コントローラチップ12 15 0は、このコンテンツ2314をICカードチップ15 0から受信し、フラッシュメモリチップ130に書きこ む。ホスト機器220は、この復号処理が成功したかを 示す情報を出力させるコマンドをMMC110に発行す る。コントローラチップ120は、ICカードチップ1 50の出力する復号結果(復号処理が成功したかを示す ICカードレスポンス)をもとにしてホスト機器220 の求める情報を構築する。そして、MMC110はその 情報をホスト機器220に送信する。ホスト機器220 が、コンテンツを無事に受信したことをコンテンツプロ 25 バイダ2310に伝えると、コンテンツプロバイダ23 10はユーザ証明書に記載されたユーザにコンテンツ料 金を課金する。ユーザは、ホスト機器220でMMC1 10内のフラッシュメモリチップ130に格納されたコ ンテンツ2314を読み出して利用することができる。 30 また、フラッシュメモリチップ130の記憶媒体に大容 量のフラッシュメモリを使用すれば、多くのコンテンツ を購入できる。本発明によれば、コンテンツ配信におけ るセキュリティ処理とコンテンツ蓄積の両方をMMC1 10によって容易に実現できる。コンテンツ料金の決済 35 を、ICカードチップ150を利用して行ってもよい。 【0026】図24と図25は、それぞれ、本発明をS Dカード(幅24ミリメートル、長さ32ミリメート ル、厚さ2。1ミリメートルで、9つの外部端子をも ち、フラッシュメモリを搭載した小型メモリカードであ 40 る。) とメモリースティック (メモリースティックはソ **二一株式会社の登録商標である。)に適用したときの簡** 単な内部構成図を表したものである。本発明を適用した SDカード2410は、SDカードコントローラチップ 2420、フラッシュメモリチップ2430、\$Dカー 45 ド外部端子2440、ICカードチップ150とを含 む。本発明を適用したメモリースティック2510は、 メモリースティックコントローラチップ2520、フラ ッシュメモリチップ2530、メモリースティック外部 端子2540、1Cカードチップ150とを含む。フラ 50 ッシュメモリチップ2430と2530は、不揮発性の

半導体メモリを記憶媒体とするメモリチップであり、フラッシュメモリコマンドによりデータの読み書きができる。SDカードコントローラチップ2420とメモリースティックコントローラチップ2520はそれぞれSDカードとメモリースティック内の他の構成要素を制御するマイコンチップである。

【0027】SDカード外部端子2440は9つの端子 からなり、それらの位置は、端からData2端子24 41、Data3端子2442、Com端子2443、 Vss端子2444、Vdd端子2445、Clock 端子2446、Vss端子2447、Data0端子2 448、Data1端子2449の順で並んでいる。V dd端子2445は電源供給端子、Vss端子2444 と2447はグランド端子、Data0端子2448と Data1端子2449とData2端子2441とD a t a 3端子2442はデータ入出力端子、Com端子 2443はコマンド入出力端子、Clock端子244 6はクロック入力端子である。SDカード2410は、 外部に接続するSDカードホスト機器2460とのイン タフェース仕様にMMC110と違いがあるものの、M MC外部端子140と非常に類似した外部端子を持ち、 MMC110と同様に外部からコマンドを発行すること により動作する特徴を持つため、本発明を適用すること ができる。

【0028】一方、メモリースティック外部端子254 0は10個の端子からなり、それらの位置は、端からG nd端子2541、BS端子2542、Vcc端子25 43、予約端子Rsvを1つ飛ばしてD10端子254 4、INS端子2545、予約端子Rsvを1つ飛ばし TSCK端子2546、Vcc端子2547、Gnd端 子2548の順で並んでいる。Vcc端子2543と2 547は電源供給端子、Gnd端子2541と2548 はグランド端子、DIO端子2544はコマンドおよび データ入出力端子、SCK端子2546はクロック入力 端子である。メモリースティック2510は、外部に接 続するメモリースティックホスト機器2560とのイン タフェース仕様にMMC110と違いがあるものの、M MC110と同様に外部からコマンドを発行することに より動作する特徴を持つため、本発明を適用することが . できる。

【0029】図1は、本発明を適用したMMCの詳細な内部構成図を表したものである。また、図2は、図1のMMC110と接続したホスト機器220の構成とその接続状態を表したものである。ホスト機器220は、VCC1電源221、CLK1発振器222、ホストインタフェース223を持つ。

【0030】MMC110は、外部のホスト機器220 と情報交換するためのMMC外部端子140を持つ。M MC外部端子140は、CS端子141、CMD端子1-42、GND1端子143および146、VCC1端子

144、CLK1端子145、DAT端子147の7つ の端子とを含む。MultiMediaCard仕様 は、MMCの動作モードとしてMMCモードとSPIモ ードという2種類を規定しており、動作モードによって 05 MMC外部端子140の使用法は異なる。本実施例では MMCモードでの動作の場合について詳細に説明する。 VCC1端子144は、VCC1電源221と接続され ており、ホスト機器220がMMC110に電力を供給 するための電源端子である。GND1端子143および 146は、VCC1電源221と接続されており、MM C110の電気的なグランド端子である。GND1端子 143とGND1端子146は、MMC110内部で電 気的に短絡されている。CS端子141は、ホストイン タフェース223に接続されており、SPIモードの動 15 作において使用される入力端子である。ホスト機器22 0が、MMC110にSPIモードでアクセスするとき には、CS端子141にLレベルを入力する。MMCモ ードの動作では、CS端子141を使用する必要はな い。CMD端子142は、ホストインタフェース223 20 に接続されており、ホスト機器220が、メモリカード インタフェース仕様に準拠したメモリカードコマンドを MMC110に送信したり、同仕様に準拠したメモリカ ードレスポンスをMMC110から受信するために使用 する入出力端子である。 DAT端子147は、ホストイ 25 ンタフェース223に接続されており、ホスト機器22 0が、メモリカードインタフェース仕様に準拠した形式 の入力データをMMC110に送信したり、同仕様に準 拠した形式の出力データをMMC110から受信するた めに使用する入出力端子である。 CLK 1 端子 1 4 5 30 は、CLK1発振器222に接続されており、CLK1 発振器222が生成するクロック信号が入力される端子 である。ホスト機器220が、CMD端子142を通し てメモリカードコマンド、メモリカードレスポンスを送 受信したり、DAT端子147を通してホストデータを 35 送受信するときに、CLK1端子145にクロック信号 が入力される。ホストインタフェース223には、CL K1発振器222からクロック信号が供給されており、 メモリカードコマンド、メモリカードレスポンス、ホス トデータは、CLK1発振器222が生成するクロック 40 信号にビット単位で同期して、ホスト機器220とMM C110との間を転送される。 【0031】MMC110は、コントローラチップ12 0を持つ。コントローラチップ120は、CPU12 1、フラッシュメモリI/F制御回路122、MMCI 45 / F制御回路123、CLK0発振器124、VCC2 生成器125、VCC2制御回路126、CLK2制御 回路127、ICカードI/F制御回路128とを含 む。これらの構成要素121~128は、ホスト機器2 20からVCC1端子144やGND1端子143、1

46を通して供給された電力により動作する。MMCI

/F制御回路123は、CS端子141、CMD端子1 42、CLK1端子145、DAT端子147と接続さ れており、MMC110がそれらの端子を通してホスト 機器220と情報交換するためのインタフェースを制御 する論理回路である。CPU121は、MMCI/F制 御回路123と接続されており、MMCI/F制御回路 123を制御する。MMCI/F制御回路123がCM D端子142を通してホスト機器220からメモリカー ドコマンドを受信すると、MMCI/F制御回路123 はそのコマンドの受信が成功したかどうかの結果をホス ト機器220に伝えるためCMD端子142を通してホ スト機器220にレスポンスを送信する。CPU121 は、受信したメモリカードコマンドを解釈し、コマンド 内容に応じた処理を実行する。また、そのコマンド内容 に応じてホスト機器220とDAT端子147を通して データの送受信をおこなう必要がある場合、 CPU12 1は、MMCI/F制御回路123へのデータの送出、 MMCI/F制御回路123からのデータの取得をおこ なう。さらに、CPU121は、MMCI/F制御回路 123とホスト機器220との間のデータ転送手続きも 制御する。例えば、ホスト機器220から受信したデー タの処理中に、ホスト機器220がMMC110への電 源供給を停止することがないように、CPU121はD AT端子147にLレベルを出力させ、MMC110が ビジー状態であることをホスト機器220に伝える。C LKO発振器124は、CPU121と接続され、CP U121を動作させる駆動クロックを供給する。

【0032】MMC110は、フラッシュメモリチップ 130を持つ。フラッシュメモリチップ130は、不揮 発性の半導体メモリを記憶媒体とするメモリチップであ る。フラッシュメモリチップ130は、ホスト機器22 0からVCC1端子144やGND1端子143、14 **6を通して供給された電力により動作する。フラッシュ** メモリチップ130は、外部からのフラッシュメモリコ マンドに従って、入力されたデータを不揮発性の半導体 メモリに格納するライト機能、また同メモリに格納され たデータを外部に出力するリード機能を持つ。フラッシ ュメモリ1/F制御回路122は、フラッシュメモリチ ップ130にフラッシュメモリコマンドを発行したり、 そのコマンドで入出力するデータを転送するための論理 回路である。CPU121は、フラッシュメモリI/F 制御回路122を制御し、フラッシュメモリチップ13 0にデータのライト機能やリード機能を実行させる。ホ スト機器220から受信したデータをフラッシュメモリ チップ130にライトしたり、フラッシュメモリチップ 130に格納されたデータをホスト機器220に送信す る必要があるとき、CPU121は、フラッシュメモリ I/F制御回路122とMMCI/F制御回路123の 間のデータ転送を制御する。

【0033】MMC110は、ICカードチップ150

を持つ。ICカードチップ150は、ICカードの基板中に埋め込むことを目的として設計されたマイコンチップであり、ICカードの外部端子規格に準拠した8つの外部端子を持つ。このうち6つの端子は、ICカードの95 外部端子規格により使用法が割り付けられており、残りの2つは将来のための予備端子である。その6つの端子は、VCC2端子151、RST端子152、CLK2端子153、GND2端子155、VPP端子156、I/O端子157である。

- 10 【0034】1 Cカードチップ150のグランド端子は、MMC外部端子140のGND1(グランド端子)146に接続される。I Cカードチップ150のVCC2端子(電源入力端子)151は、コントローラチップ120のVCC2制御回路126に接続される。I Cカードチップ150のRST端子(リセット入力端子)152と1/〇端子(データ入出力端子)157は、コントローラチップ120のI Cカード1/F制御回路128に接続される。I Cカードチップ150のCLK2端子(クロック入力端子)153は、コントローラチップ120のCLK2制御回路127に接続される。
- 【0035】フラッシュメモリチップ130のVCC端子(電源入力端子)は、MMC外部端子140のVCC1144に接続される。フラッシュメモリチップ130のVSS端子(グランド端子)は、MMC外部端子140のVSS端子(グランド端子)は、MMC外部端子140のGND1146に接続される。フラッシュメモリチップ130のI/O端子(データ入出力端子)とレディ/ビジー端子とチップイネーブル端子とアウトプットイネーブル端子とライトイネーブル端子とクロック端子とリセット端子とは、コントローラチップ120のフラッシュメモリIF制御回路122に接続される。

【0036】VCC2端子151は、ICカードチップ 150に電力を供給するための電源端子である。 VCC 2制御回路126は、MOS-FET素子を用いたスイ ッチ回路によりVCC2端子151への電力の供給開始 35 と供給停止を制御する回路である。VCC2生成器12 5はVCC2端子151に供給する電圧を発生し、それ をVCC2制御回路126に供給する。ICカードの電 気信号規格はICカードの動作クラスとしてクラスAと クラスBを規定している。VCC2端子151に供給す 40 る標準電圧は、クラスAでは5V、クラスBでは3Vで ある。本発明はICカードチップ150の動作クラスに よらず適用できるが、本実施例ではICカードチップ1 50がクラスBで動作する場合について詳細に説明す る。VPP端子156は、ICカードチップ150がク 45 ラスAで動作する時に、内部の不揮発性メモリにデータ を書き込んだり消去したりするために使用される可変電

を書き込んだり消去したりするために使用される可変電圧を供給する端子であり、クラスBで動作する時には使用しない。GND2端子155は、ICカードチップ150の電気的なグランド端子であり、GND1端子14503、146と短絡されている。VCC2制御回路126

はCPU121と接続され、CPU121はVCC2端子151への電力供給の開始と停止を制御することができる。ICカードチップ150を使用しないときは、CPU121はVCC2端子151への電力供給を停止することができる。MMC110は、ICカードチップ150への電力供給を停止することにより、それが消費する電力を節約することができる。ただし、電力供給を停止すると、ICカードチップ150の内部状態は、ICカードチップ150内部の不揮発性メモリに記憶されたデータを除いて維持されない。

【0037】CLK2端子153は、1Cカードチップ 150にクロック信号を入力する端子である。

【0038】CLK2制御回路127は、CLK2端子 153にクロックを供給する回路である。CLK2制御 回路127は、CLK0発振器124から供給されたク ロック信号をもとにしてCLK2端子153に供給する クロック信号を生成する。CLK2制御回路127はC PU121と接続されており、CLK2端子153への クロックの供給開始と供給停止をCPU121から制御 することができる。 I Cカードチップ150は、自身内 部に駆動クロック発振器をもたない。そのため、CLK 2端子153から駆動クロックを供給することによって 動作する。CLK2制御回路127が、CLK2端子1. 53へのクロック供給を停止すると、ICカードチップ 150の動作は停止するため、ICカードチップ150 の消費電力を低下させることができる。この時、VCC 2端子151への電力供給が保たれていれば、ICカー ドチップ150の内部状態は維持される。ここで、CL K2端子153に供給するクロック信号の周波数をF 2、CLK0発振器124から供給されたクロック信号 の周波数をF0、PとQを正の整数とすると、CLK2 制御回路127は、F2= (P/Q) *F0の関係にな るようなクロック信号を作成して、これをCLK2端子 153に供給する。PとQの値はCPU121により設 定できるようになっている。Pを大きく設定してF2を 大きくすると、ICカードチップ150の内部処理をよ り高速に駆動できる。Qを大きく設定してF2を小さく すると、ICカードチップ150の内部処理はより低速 に駆動され、ICカードチップ150の消費電力を低下 させることができる。ICカードチップ150の駆動ク ロック周波数は、ICカードチップ150が正しく動作 できるような許容周波数範囲内に設定される必要があ る。そのため、CLK2制御回路127は、F2の値が その許容周波数範囲を外れるようなPとQの値を設定さ せない特徴を持つ。

【0039】 I/〇端子157は、ICカードチップ150にICカードコマンドを入力したり、ICカードチップ150がICカードレスポンスを出力するときに使用する入出力端子である。ICカードI/F制御回路128は、I/〇端子157と接続されており、I/〇端

子157を通してICカードコマンドの信号送信やIC カードレスポンスの信号受信をおこなう回路である。1 Cカード1/F制御回路128はCPU121に接続さ れており、CPU121は、ICカードI/F制御回路 128によるICカードコマンドやICカードレスポン スの送受信の手続きを制御したり、送信すべきICカー ドコマンドデータをICカードI/F制御回路128に 設定したり、受信したICカードレスポンスをICカー ドI/F制御回路128から取得する。ICカードI/ 10 F制御回路128にはCLK2制御回路127からクロ ックが供給されており、ICカードコマンドやICカー ドレスポンスは、CLK2端子153に供給するクロッ ク信号にビット単位で同期して、I/O端子157を通 して送受信される。また、RST端子152は、ICカ 15 ードチップ150をリセットするときにリセット信号を 入力する端子である。 1 Cカード1/F制御回路128 は、RST端子152と接続されており、CPU121 の指示により I Cカードチップ 150 にリセット信号を 送ることができる。

【0040】 I Cカードチップ150は、1 Cカードの 電気信号規格やコマンド規格に基づいて情報交換をおこ なう。ICカードチップ150へのアクセスパターンは 4種類であり、図3~図6を用いて各パターンを説明す る。図3は、CPU121の指示により1Cカードチッ 25 プ150が非活性状態(電源が遮断されている状態)か ら起動して内部状態を初期化するプロセス(以下、コー ルドリセットと呼ぶ)において、ICカードチップ15 0の外部端子の信号波形をシンプルに表したものであ る。図4は、CPU121の指示によりICカードチッ 30 プ150が活性状態(電源が供給されている状態)で内 部状態を初期化するプロセス(以下、ウォームリセット と呼ぶ)において、1Cカードチップ150の外部端子。 の信号波形をシンプルに表したものである。図5は、C PU121の指示によりICカードチップ150にIC 35 カードコマンドを送信しICカードチップ150から I Cカードレスポンスを受信するプロセスにおいて、IC カードチップ150の外部端子の信号波形をシンプルに 表したものである。図6は、CPU121の指示により ICカードチップ150を非活性状態にするプロセスに 40 おいて、ICカードチップ150の外部端子の信号波形 をシンプルに表したものである。図3~図6において、 時間の方向は左から右にとっており、上の行から下の行 に向かってVCC2端子151、RST端子152、C LK2端子153、I/O端子157で観測される信号 45 を表す。また、破線はそれぞれの信号の基準 (Lレベ ル). を表す。

【0041】図3を参照して、ICカードチップ150のコールドリセット操作を説明する。まず、ICカードI/F制御回路128はRST端子152をLレベルに50 する(301)。次に、VCC2制御回路126はVC

C 2 端子への電源供給を開始する(302)。次に、C L K 2 制御回路 1 2 7 は C L K 2 端子 1 5 3 へのクロック信号の供給を開始する(303)。次に、I C カード I / F 制御回路 1 2 8 は I / O 端子 1 5 7 を 状態 Z (プルアップされた 状態)にする(304)。次に、I C カード I / F 制御回路 1 2 8 は R S T 端子 1 5 2 を H レベルにする(305)。次に、I C カード I / F 制御回路 1 2 8 は I / O 端子 1 5 7 から出力される リセット 応答の 受信を 開始する(306)。リセット 応答の 受信が終了したら、C L K 2 制御回路 1 2 7 は C L K 2 端子 1 5 3 へのクロック信号の供給を 停止する(307)。これで、コールドリセットの 操作が 完了する。なお、ステップ 307 は 消費電力を 低下させる ための 工夫であり、省略してもよい。

【0042】図4を参照して、ICカードチップ150 のウォームリセット操作を説明する。まず、CLK2制 御回路127はCLK2端子153へのクロック信号の 供給を開始する(401)。次に、ICカードI/F制 御回路128はRST端子152をLレベルにする(4 02)。次に、ICカードI/F制御回路128はI/ 〇端子157を状態2にする(403)。次に、ICカ ード I / F制御回路128はRST端子152をHレベ ルにする(404)。次に、ICカードI/F制御回路 128は1/〇端子157から出力されるリセット応答 の受信を開始する(405)。リセット応答の受信が終 了したら、CLK2制御回路127はCLK2端子15 3へのクロック信号の供給を停止する(406)。これ で、ウォームリセットの操作が完了する。なお、ステッ プ406は消費電力を低下させるための工夫であり、省 略してもよい。

【0043】図5を参照して、ICカードチップ150 にICカードコマンドを送信しICカードチップ150 からICカードレスポンスを受信する操作を説明する。 まず、CLK2制御回路127はCLK2端子153へ のクロック信号の供給を開始する(501)。なお、ク ロックがすでに供給されている場合、ステップ501は 不要である。次に、ICカードI/F制御回路128は I/O端子157にコマンドデータの送信を開始する (502)。コマンドデータの送信が終了したら、IC カード I / F制御回路 1 2 8 は I / 〇端子 1 5 7 を状態 Zにする(503)。次に、ICカードI/F制御回路 128は1/〇端子157から出力されるレスポンスデ ータの受信を開始する(504)。レスポンスデータの 受信が終了したら、CLK2制御回路127はCLK2 ・端子153へのクロック信号の供給を停止する(50 5)。これで、ICカードコマンド送信とICカードレ スポンス受信の操作が完了する。なお、ステップ505 は、消費電力を低下させるための工夫であり、省略して もよい。

【0044】図6を参照して、1Cカードチップ150

を非活性化する操作を説明する。まず、CLK2制御回路127はCLK2端子153をLレベルにする(601)。次に、ICカード1/F制御回路128はRST端子152をLレベルにする(602)。次に、ICカの5ード1/F制御回路128はI/O端子157をLレベルにする(603)。最後に、VCC2制御回路126はVCC2端子への電源供給を停止する(604)。これで、非活性化の操作が完了する。

【0045】 I Cカードチップ150は、機密データ保 10 護や個人認証などに必要な暗号演算をおこなうセキュリ ティ処理機能を持つ。ICカードチップ150は、CP U121との間でICカードコマンドやICカードレス ポンスの送受信することにより情報交換をおこない、そ の結果として、計算の結果や記憶されている情報の送 15 出、記憶されている情報の変更などをおこなう。CPU 121は、ICカードチップ150を利用してセキュリ ティ処理を実行することができる。MMC110がホス ト機器220から特定のメモリカードコマンドを受信す ると、CPU121はそれを契機として、VCC2制御 20 回路 1 2 6 を通して I Cカードチップ 1 5 0 への電源供 給を制御したり、またはCLK2制御回路127を通し てICカードチップ150へのクロック供給を制御した り、またはICカードI/F制御回路128を通してI Cカードチップ150にICカードコマンドを送信す 25 る。これにより、CPU121は、ICカードチップ1 50を利用して、ホスト機器220が要求するセキュリ ティ処理を実行する。CPU121は、特定のメモリカ ードコマンドの受信を契機に、ICカードチップ150 に対する電源供給制御、クロック供給制御、ICカード コマンド送信、ICカードレスポンス受信を複数組み合 わせて操作することによって、セキュリティ処理を実行 してもよい。また、CPU121は、ホスト機器220 がMMC110へ電源供給を開始したのを契機として、 セキュリティ処理を実行してもよい。セキュリティ処理 35 の結果は、ICカードチップ150が出力するICカー ドレスポンスをベースにして構成され、MMC110内 に保持される。MMC110がホスト機器220から特 定のメモリカードコマンドを受信すると、CPU121 はそれを契機として、セキュリティ処理の結果をホスト

【0046】図7は、ホスト機器220がMMC110にアクセスするときのフローチャートを表したものである。まず、ホスト機器220はMMC110を活性化するためにVCC1端子144に電源供給を開始する(74501)。これを契機として、MMC110は、第1次1Cカード初期化処理を実行する(702)。第1次1Cカード初期化処理の詳細は後述する。次に、ホスト機器220はMMC110を初期化するためにCMD端子142を通してMMC110の初期化コマンドを送信する50(703)。この初期化コマンドはMultiMedi

40.機器220に送信する。

aCard仕様に準拠したものであり、複数種類ある。 ホスト機器220は、MMC110を初期化するため に、複数の初期化コマンドを送信する場合がある。MM C110が初期化コマンドを受信すると、MMC110 はそれを処理する(704)。これを契機として、MM C110は、第2次ICカード初期化処理を実行する (705)。第2次ICカード初期化処理の詳細は後述 する。ホスト機器220は、MMC110の初期化コマ ンドに対するメモリカードレスポンスを、CMD端子1 42を通して受信し、そのメモリカードレスポンスの内 容からMMC110の初期化が完了したかを判定する。 未完了ならば、再び初期化コマンドの送信をおこなう (703)。MMC110の初期化が完了したならば、 ホスト機器220は、MultiMediaCard仕 様に準拠した標準メモリカードコマンド(フラッシュメ モリチップ130ヘアクセスするためのコマンド)や、 上に述べたセキュリティ処理に関連した特定のメモリカ ードコマンド (ICカードチップ150ヘアクセスする) ためのコマンド)の送信を待機する状態に移る(70 7)。この待機状態では、ホスト機器220は標準メモ リカードコマンドを送信することができる(708)。 MMC110が標準メモリカードコマンドを受信した ら、MMC110はそれを処理する(709)。処理が 完了したら、ホスト機器220は、再び待機状態にもど る(707)。この待機状態では、ホスト機器220は セキュリティ処理要求ライトコマンドを送信することも できる(710)。セキュリティ処理要求ライトコマン ドとは、上に述べたセキュリティ処理に関連した特定の メモリカードコマンドの1種であり、MMC110にセ キュリティ処理を実行させるために処理要求を送信する メモリカードコマンドである。MMC110がセキュリ ティ処理要求ライトコマンドを受信したら、 CPU12 1は、要求されたセキュリティ処理の内容を解釈し、セ キュリティ処理をICカードコマンドの形式で記述する (711)。即ち、CPU121は、予め定められたル ールに従って、ホスト機器230からの標準メモリカー ドコマンドを、ICカードチップ150が解釈可能な特 定のメモリカードコマンドへ変換する。そして、その結 果として得られたICカードコマンドをICカードチッ プ150に発行するなどして、要求されたセキュリティ 処理を実行する(712)。処理が完了したら、ホスト 機器220は、再び待機状態にもどる(707)。この 待機状態では、ホスト機器220はセキュリティ処理結 果リードコマンドを送信することもできる(713)。 セキュリティ処理結果リードコマンドとは、上に述べた セキュリティ処理に関連した特定のメモリカードコマン ドの1種であり、MMC110によるセキュリティ処理 の実行結果を知るために処理結果を受信するメモリカー ドコマンドである。MMC110がセキュリティ処理結 果リードコマンドを受信したら、CPU121は、IC

カードチップ150から受信したICカードレスポンスをベースに、ホスト機器220に送信すべきセキュリティ処理結果を構築する(714)。そして、ホスト機器220は、MMC110からセキュリティ処理結果を受65信する。受信が完了したら、ホスト機器220は、再び待機状態にもどる(707)。なお、ステップ714は、ステップ712の中でおこなってもよい。

【0047】図7において、ステップ702およびステ ップ705で実行する第1次ICカード初期化処理およ 10 び第2次ICカード初期化処理は、MMC110内でセ キュリティ処理を実行するのに備えて、CPU121が ICカードチップ150に対してアクセスする処理であ る。具体的には、 I Cカードチップ150の活性化や非 活性化、ICカードチップ150のリセット、ICカー 15 ドチップ150の環境設定を行う。環境設定とは、セキ ュリティ処理を実行するために必要な情報(例えば、使 用可能な暗号アルゴリズムの情報、暗号計算に使用する 秘密鍵や公開鍵に関する情報、個人認証に使用する認証 データに関する情報など)をICカードチップ150か ら読み出したり、あるいはICカードチップ150に書 20 き込んだりすることを意味する。 I C カードチップ15 0の環境設定は、ICカードチップ150にICカード コマンドをN個(Nは正の整数)発行することによって おこなう。例えば、セッション鍵が3個必要ならば、1 Cカードコマンドを3回発行し、セッション鍵が2個必 要ならば、1Cカードコマンドを2回発行する。N個の ICカードコマンドは、互いに相違するものであっても よいし、同一のものであってもよい。Nの値は固定され たものではなく、状況によってさまざまな値となる。以 下、環境設定で発行するICカードコマンドを、設定コ マンドと呼ぶ。また、この環境設定に基づいてセキュリ ティ処理を実行するICカードコマンドを、以下、セキ ュリティコマンドと呼ぶ。セキュリティコマンドの例と しては、デジタル署名の計算、デジタル署名の検証、メ ッセージの暗号化、暗号化メッセージの復号、パスワー ドによる認証などをおこなうコマンドがある。

【0048】CPU121は、ICカードチップ150の環境設定の内容を自由に変更することができる。CPU121は、セキュリティ処理の内容や結果に応じてこれを変更してもよいし、ホスト機器からのメモリカードコマンドの受信を契機としてこれを変更してもよい。また、CPU121は、環境設定の内容を示した情報をフラッシュメモリチップ130からその情報をリードして使用することもできる。この情報は、図21においてICカード環境設定情報2112として示されている。これにより、MMC110が非活性化されてもその情報を保持することができ、MMC110が活性化されるたびにあらためて設定する手間を省くことができる。

50 【0049】第1次1Cカード初期化処理および第2次

ICカード初期化処理は、ICカード制御パラメータ A、B、Cに設定された値に基づいておこなわれる。ま た、CPU121は、ステップ712で実行するセキュ リティ処理において、ICカード制御パラメータDに設 定された値に基づいてICカードチップ150の活性化 や非活性化を制御する。図8は、ICカード制御パラメ 一夕の種類と設定値、それに対応した処理の内容を表し ている。まず、パラメータAは、MMC110に電源が 供給されたときに実行される第1次ICカード初期化処 理に関するパラメータである。A=0のときは、CPU 121はICカードチップ150にアクセスしない。A =1のときは、CPU121はICカードチップ150 をコールドリセットする。A=2のときは、CPU12 1は1Cカードチップ150をコールドリセットした後 でICカードチップ150の環境設定をおこなう。A= 3のときは、CPU121はICカードチップ150を コールドリセットした後でICカードチップ150の環 境設定をおこない、最後にICカードチップ150を非 活性化する。A=0またはA=3のときは、第1次IC カード初期化処理のあとICカードチップ150が非活 性状態となる。A=1またはA=2のときは、第1次Ⅰ Cカード初期化処理のあとICカードチップ150は活 性状態となる。次に、パラメータBとCは、MMC11 0がMMC初期化コマンドを処理したときに実行される 第2次 I Cカード初期化処理に関するパラメータであ る。B=0のときは、CPU121はICカードチップ 150にアクセスしない。B=1かつC=1のときは、 CPU121はICカードチップ150をリセット (コ ールドリセットまたはウォームリセット) する。B=1 かつC=2のときは、CPU121はICカードチップ 150をリセットした後でICカードチップ150の環 境設定をおこなう。B=1かつC=3のときは、CPU 121はICカードチップ150をリセットした後でI Cカードチップ150の環境設定をおこない、最後にI Cカードチップ150を非活性化する。B=2かつC= 2のときは、CPU121はICカードチップ150の 環境設定をおこなう。B=2かつC=3のときは、CP U121はICカードチップ150の環境設定をおこな った後に I Cカードチップ150を非活性化する。B= 3のときは、ICカードチップ150が活性状態なら ば、CPU121はICカードチップ150を非活性化 する。最後に、パラメータDは、ホスト機器220から 要求されたセキュリティ処理を実行したあとに、ICカ ードチップ150を非活性化するか否かを示すパラメー タである。D=0のときは、セキュリティ処理の実行後 に、CPU121はICカードチップ150を非活性化 せず、活性状態に保つ。D=1のときは、セキュリティ 処理の実行後に、CPU121はICカードチップ15 0を非活性化する。

【0050】CPU121は、ICカード制御パラメー

タA、B、C、Dの設定値を変更することができる。C PU121は、セキュリティ処理の内容や結果に応じてこれらの設定値を変更してもよいし、ホスト機器からのメモリカードコマンドの受信を契機としてこれらの設定値を変更してもよい。また、CPU121は、これらの設定値をフラッシュメモリチップ130からこれらの設定値をリードして使用することもできる。これらの設定値なリードして使用することもできる。これらの設定値は、図21において1Cカード制御パラメータ2111として示されている。これにより、MMC110が非活性化されてもこれらの設定値を保持することができ、MMC110が活性化されるたびにあらためて設定する手間を省くことができる。

【0051】図9は、第1次ICカード初期化処理のフローチャートを表している。初期化処理を開始する(901)と、まず、ICカード制御パラメータAが0かチェックする(902)。A=0ならばそのまま初期化処理は終了する(908)。A=0でないならばICカードチップ150をコールドリセットする(903)。次に、ICカード制御パラメータAが1かチェックする(904)。A=1ならば初期化処理は終了する(908)。A=1でないならばICカードチップ150の環境設定をおこなう(905)。次に、ICカード制御パラメータAが2かチェックする(906)。A=2ならば初期化処理は終了する(908)。A=2でないならばICカードチップ150を非活性化する(907)。そして、初期化処理は終了する(908)。

フローチャートを表している。初期化処理を開始する (1001) と、まず、ICカード制御パラメータBが 0かチェックする (1002)。 B=0ならばそのまま 初期化処理は終了する(1013)。B=0でないなら Cカード制御パラメータAが0または3かチェックする (1004)。Aが0または3ならば、ICカードチッ プ150をコールドリセットし(1005)、ステップ 1007に移る。Aが1または2ならば、ICカードチ ップ150をウォームリセットし(1006)、ステッ プ1007に移る。ステップ1007では、ICカード 40 制御パラメータCが1かチェックする。C=1ならば初 期化処理は終了する(1013)。C=1でないならば ステップ1009に移る。ステップ1003においてB = 1 でないならば、Bが2かチェックする(100 8)。B=2ならばステップ1009に移る。B=2で

Cカードチップ150の環境設定をおこなう。そして、 50 ICカード制御パラメータCが2かチェックする(10

45 ないならば、ICカード制御パラメータAが0または3

かチェックする(1011)。Aが0または3ならば初

期化処理を終了する(1013)。Aが1または2なら

ば、ステップ1012に移る。ステップ1009では1

10)。 C=2ならば初期化処理を終了する (101 3)。C=2でないならばステップ1012に移る。ス テップ1012ではICカードチップ150を非活性化 する。そして、初期化処理を終了する(1013)。 【0053】図11は、1Cカードチップ150が非活 性状態であるときに第1次1Cカード初期化処理あるい は第2次ICカード初期化処理を実行した場合におい て、ICカードチップ150の外部端子の信号波形をシ ンプルに表したものである。図12は、ICカードチッ プ150が活性状態であるときに第2次ICカード初期 化処理を実行した場合において、 I Cカードチップ15 0の外部端子の信号波形をシンプルに表したものであ る。図11と図12において、時間の方向は左から右に とっており、上の行から下の行に向かってVCC2端子 151、RST端子152、CLK2端子153、I/ 〇端子157で観測される信号を表す。また、横方向の 破線はそれぞれの信号の基準 (Lレベル) を表す。図1 1において1102は図3に示したコールドリセットの 信号波形を表す。図12において1202は図4に示し たウォームリセットの信号波形を表す。図11と図12 において、第1設定コマンド処理1104aと1204 a、第2設定コマンド処理1104bと1204b、第 N設定コマンド処理1104cと1204cは、それぞ れ図5に示した I Cカードコマンド処理の信号波形を表 す。 ICカードチップ150の環境設定の信号波形11 04と1204は、N個の設定コマンド処理の信号波形 が連なって構成される。図11と図12において、11 06と1206は、それぞれ図6に示した非活性化の信 号波形を表す。図11と図12において、縦方向の破線 1101, 1103, 1105, 1107, 1201, 1203、1205、1207はそれぞれ特定の時刻を 表す。1101はコールドリセット前の時刻、1201 はウォームリセット前の時刻、1103はコールドリセ ット後から環境設定前の間にある時刻、1203はウォ ームリセット後から環境設定前の間にある時刻、110 5と1205は環境設定後から非活性化前の間にある時 刻、1107と1207は非活性化後の時刻である。

【0054】図11を参照して、第1次I Cカード初期 化処理実行時の信号波形を示す。I Cカード制御パラメータAが0 のときは、信号波形に変化はない。A=1 のときは、時刻1101から時刻1103までの範囲の信号波形となる。A=2 のときは、時刻1101から時刻1105までの範囲の信号波形となる。A=3 のときは、時刻1105までの範囲の信号波形となる。A=3 のとき は、時刻1101から時刻1107までの範囲の信号波形となる。

【0055】図11を参照して、ICカード制御パラメータAが0または3のときの、第2次ICカード初期化処理実行時の信号波形を示す。ICカード制御パラメータBが0のときは、信号波形に変化はない。B=1かつICカード制御パラメータC=1のときは、時刻110

1から時刻1103までの範囲の信号波形となる。B=1かつC=2のときは、時刻1101から時刻1105までの範囲の信号波形となる。B=1かつC=3のときは、時刻1101から時刻1107までの範囲の信号波の5 形となる。

【0056】図12を参照して、ICカード制御パラメータAが1または2のときの、第2次ICカード初期化処理実行時の信号波形を示す。ICカード制御パラメータBが0のときは、信号波形に変化はない。B=1かつ10 ICカード制御パラメータC=1のときは、時刻1201から時刻1203までの範囲の信号波形となる。B=1かつC=2のときは、時刻1201から時刻1205までの範囲の信号波形となる。B=1かつC=3のときは、時刻1207までの範囲の信号波形となる。B=2かつC=2のときは、時刻1203から時刻1205までの範囲の信号波形となる。B=2かつC=3のときは、時刻1207までの範囲の信号波形となる。B=3のときは、時刻1205から時刻1207までの範囲の信号波形となる。B=3のときは、時刻1205から時刻1207までの範囲の信号波形となる。

【0057】図13は、図7のステップ712におい て、СРU121が、ホスト機器220が要求したセキ ユリティ処理をICカードチップ150によって実行す るときのフローチャートを表している。セキュリティ処 理を開始する(1301)と、まずICカードチップ1 25 50が非活性状態かをチェックする(1302)。非活 性状態ならば、ICカードチップ150をコールドリセ ットし(1303)、ステップ1306に移る。活性状 態ならば、ステップ1304に移る。ステップ1304 では、ICカードチップ150にICカードコマンドを 30 発行する前に I Cカードチップ 1 5 0 を再リセットする 必要があるかをチェックする。必要があるならば、IC カードチップ150をウォームリセットし(130 5)、ステップ1306に移る。必要がないならば、ス テップ1306に移る。ステップ1306では、ICカ 35 ードチップ150の環境設定をおこなう必要があるかを チェックする。必要があるならば、ICカードチップ1 50の環境設定をおこない(1307)、ステップ13 08に移る。必要がないならば、ステップ1308に移 る。ステップ1308では、1Cカードチップ150の 40 CLK2端子に供給するクロック信号の周波数F2を設 定する。そして、CPU121はICカードチップ15 0 にセキュリティコマンドを発行し、 I Cカードチップ 150はそれを処理する(1309)。セキュリティコ マンドの処理時間は、クロック周波数F2に依存する。

45 次に、ICカードチップ150が出力するICカードレスポンスにより、その処理が成功したかどうかを判定する(1310)。成功ならば、ステップ1311に移る。失敗ならば、ステップ1312に移る。ステップ1311では、ICカードチップ150に発行すべきセキ50 ュリティコマンドが全て完了したかをチェックする。発

行すべきセキュリティコマンドがまだあるならば、ステ ップ1304に移る。発行すべきセキュリティコマンド が全て完了したならば、ステップ1314に移る。ステ ップ1312では、失敗したセキュリティコマンドをリ トライすることが可能かを判定する。リトライできるな ら、リトライ設定をおこない(1313)、ステップ1 304に移る。リトライ設定とは、リトライすべきセキ ュリティコマンドやその関連データをCPU121が再 度準備することである。リトライできないならステップ 1314に移る。これは、ホスト機器220が要求した セキュリティ処理が失敗したことを意味する。ステップ 1314では、ICカード制御パラメータDをチェック する。D=1ならば、ICカードチップ150を非活性 化して(1315)、セキュリティ処理を終了する(1 316)。D=1でないならば、ICカードチップ15 0 を活性状態に保ったままセキュリティ処理を終了する (1316)。図13のフローチャートにおいては、ク ロック周波数F2を、ステップ1309で発行するセキ ュリティコマンドの種類によって変えることができるよ うに、ステップ1308をステップ1309の直前に位 置させたが、ステップ1308はそれ以外の位置にあっ

【0058】従来のICカードへの攻撃法を有効にして いる要因のひとつとして、ICカードの駆動クロックが 外部の接続装置から直接供給されることがあげられる。 駆動クロックが接続装置の制御下にあるため、タイミン グ解析や電力差分解析においては、電気信号の測定にお いてICカード内部処理のタイミングの獲得が容易にな る。一方、故障利用解析においては、異常な駆動クロッ クの供給による演算エラーの発生が容易になる。これに 対し、本発明によれば、MMC110内部でICカード チップ150によりセキュリティ処理を実行するとき、 ホスト機器220はICカードチップ150の駆動クロ ックを直接供給できない。CPU121は、ICカード チップ150へ供給するクロックの周波数F2を自由に 設定することができる。これにより、ホスト機器220 の要求する処理性能に柔軟に対応したセキュリティ処理 が実現できる。ホスト機器220が高速なセキュリティ 処理を要求するならば周波数F2を高く設定し、低い消 費電力を要求するならば周波数F2を低く設定したり、 クロックを適度に停止させればよい。また、CPU12 1は、周波数F2だけでなくクロックの供給開始タイミ ング、供給停止タイミングを自由に設定できる。これら をランダムに変化させることにより、ICカードチップ 150に対するタイミング解析、電力差分解析、故障利 用解析と呼ばれる攻撃法を困難にすることができる。タ イミング解析は、攻撃者が暗号処理1回の処理時間を正 確に計測可能であることを仮定しているため、その対策 としては、攻撃者が処理時間計測を正確に行えないよう にすることが有効である。本発明によりタイミング解析

が困難になる理由は、 I Cカードチップ150が I Cカ ·ードコマンドを処理している時間の長さをホスト機器2 20が正確に計測できないためである。電力差分解析の 対策としては、処理の実行タイミングや順序に関する情 報を外部から検出不可能にすることが有効である。本発 明により電力差分解析が困難になる理由は、ICカード コマンドが発行された時刻、発行されたICカードコマ ンドの内容、発行されたICカードコマンドの順序(I Cカードコマンドを複数組み合わせてセキュリティ処理 10 を実行する場合)の検出がホスト機器220にとって困 難になるためである。故障利用解析の対策としては、Ⅰ Cカードにクロックや電圧や温度等の動作環境検知回路 を搭載し、異常を検出したならば処理を停止あるいは使 用不能にするという方法が有効である。本発明により故 15 障利用解析が困難になる理由は、CLK2制御回路12 7が1Cカードチップ150に異常な駆動クロックを供 給しないことが、ホスト機器220がICカードチップ 150に演算エラーを発生させるのを防止するからであ

20 【0059】CPU121は、ICカードチップ150に供給するクロックの周波数F2、供給開始タイミング、供給停止タイミングの設定値を、セキュリティ処理の内容や結果に応じて変更してもよいし、ホスト機器からのメモリカードコマンドの受信を契機として変更してもよい。また、CPU121は、これらの設定値をフラッシュメモリチップ130からこれらの設定値をリードして使用することもできる。これらの設定値は、図21においてCLK2設定情報2113として示されている。これにより、MMC110が非活性化されてもこれらの設定値を保持することができ、MMC110が活性化されるたびにあらためて設定する手間を省くことができる。

【0060】図14は、ホスト機器220がセキュリテ 35 ィ処理要求ライトコマンドをMMC110に発行してか ら、ICカードチップ150でセキュリティ処理が実行 されるまでの過程(図7のステップ710~712)に おいて、MMC110およびICカードチップ150の 外部端子の信号波形、CPU121によるフラッシュメ 40 モリチップ130へのアクセスをシンプルに表したもの である。図14において、時間の方向は左から右にと る。一番上の行はフラッシュメモリチップ130へのア クセス内容である。上から二行目の行から下の行に向か って、VCC1端子144、CMD端子142、CLK 45 1 端子 1 4 5、DAT端子 1 4 7、VCC 2 端子 1 5 1、RST端子152、CLK2端子153、I/O端 子157で観測される信号を表す。また、横方向の破線 はそれぞれの信号の基準(Lレベル)を表す。図14を 参照して、ホスト機器220がセキュリティ処理要求ラ 50 イトコマンドをMMC110に発行してから、1Cカー

ドチップ150でセキュリティ処理が実行されるまでの 過程を説明する。まず、ホスト機器220はCMD端子 142にセキュリティ処理要求ライトコマンドを送信す る (1401)。次に、ホスト機器220はCMD端子 142からセキュリティ処理要求ライトコマンドのレス ポンスを受信する(1402)。このレスポンスは、M MC110がコマンドを受信したことをホスト機器22 0に伝えるものであり、セキュリティ処理の実行結果で はない。次に、ホスト機器220はDAT端子147に セキュリティ処理要求を送信する(1403)。セキュ リティ処理要求とは、セキュリティ処理の内容や処理す べきデータを含むホストデータである。次に、MMC1 10はDAT端子147をLレベルにセットする(14 04)。MMC110は、これによりビジー状態である ことをホスト機器220に示す。次に、CPU121 は、ホスト機器220から受信したセキュリティ処理要 求をフラッシュメモリチップ130にライトするコマン ドを発行する(1405)。セキュリティ処理要求をフ ラッシュメモリチップ130にライトすることにより、 CPU121がセキュリティ処理要求をICカードコマ ンド形式で記述する処理(図7のステップ711)にお いて、CPU121内部のワークメモリの消費量を節約 できる。これは、セキュリティ処理要求のデータサイズ が大きいときに有効である。なお、フラッシュメモリチ ップ130にライトされたセキュリティ処理要求は、図 21においてセキュリティ処理バッファ領域2114に 格納される。また、ライトコマンド発行1405は必須 な操作ではない。ライト処理期間1406は、フラッシ ュメモリチップ130がセキュリティ処理要求のライト 処理を実行している期間を表す。セキュリティ処理14 07は1Cカードチップ150によるセキュリティ処理 の信号波形を表す。この信号波形は図13のフローチャ ートの遷移過程に依存する。セキュリティ処理1407 は、ライト処理期間1406とオーバラップさせること ができる。一般にフラッシュメモリチップ130のライ ト処理期間1406はミリ秒のオーダーであるため、セ キュリティ処理1407とオーバラップさせることは、 セキュリティ処理の全体的な処理時間の短縮にとって有 効である。リード/ライト1408は、セキュリティ処 理1407の実行中に、フラッシュメモリチップ130 からセキュリティ処理要求をリードしたり、ICカード チップ150が出力した計算結果をフラッシュメモリチ ップ130にライトするアクセスを示している。このア クセスにより、CPU121内部のワークメモリの消費 量を節約できる。これは、セキュリティ処理要求やセキ ュリティ処理結果のデータサイズが大きいときに有効で ある。リード/ライト1408は必須ではない。セキュ リティ処理1407が完了したら、MMC110はDA T端子147をHレベルにセットする(1409)。M MC110は、これによりセキュリティ処理が完了した

ことをホスト機器220に示す。 【0061】図15は、図14におけるセキュリティ処 理1407の信号波形の一例を表したものである。図1 5 において、時間の方向は左から右にとる。一番上の行 05 はフラッシュメモリチップ130へのアクセス内容であ る。上から二行目の行から下の行に向かって、VCC2 端子151、RST端子152、CLK2端子153、 I/O端子157で観測される信号を表す。また、横方 向の破線はそれぞれの信号の基準(Lレベル)を表す。 1501は図3に示したコールドリセットの信号波形を 表し、1504は図4に示したウォームリセットの信号 波形を表し、1502および1505は図11 (あるい は図12)に示した環境設定の信号波形を表し、150 3および1·506および1507は図5に示したICカ 15 ードコマンド処理の信号波形を表し、1508は図6に 示した非活性化の信号波形を表す。 I Cカードチップ1 50の外部端子において図15に示した信号波形が観測 されるのは、図13のフローチャートが1301、13 02, 1303, 1306, 1307, 1308, 13 09, 1310, 1311, 1304, 1305, 13 06, 1307, 1308, 1309, 1310, 13 11, 1304, 1306, 1308, 1309, 13 10、1311、1314、1315、1316の順で 遷移するときである。図15を参照して、図14のセキ 25 ユリティ処理 1 4 0 7 の実行中における C P U 1 2 1 に よるフラッシュメモリチップ130へのアクセス (リー ド/ライト1408)を説明する。このアクセスには、 図21におけるセキュリティ処理バッファ領域2114 を使用する。リード1509、1511、1512は、 30 それぞれ、セキュリティコマンド処理1503、150 6、1507においてICカードチップ150に送信す るICカードコマンドを構築するために必要なデータ を、フラッシュメモリチップ130からリードするアク セスである。ライト1510は、セキュリティコマンド 35 処理1503においてICカードチップ150が出力し た計算結果を、フラッシュメモリチップ130にライト するアクセスである。ライト1513は、セキュリティ コマンド処理1506および1507においてICカー ドチップ150が出力した計算結果を、フラッシュメモ リチップ130にまとめてライトするアクセスである。 40 リード1509、1511、1512は、それぞれ、セ キュリティコマンド処理1503、1506、1507 以前の I Cカードチップ 150へのアクセスとオーバラ ップさせることができる。ライト1510、1513 45 は、それぞれ、セキュリティコマンド処理1503、1 507以後のICカードチップ150へのアクセスとオ ーバラップさせることができる。これらのオーバラップ は、セキュリティ処理の全体的な処理時間の短縮にとっ て有効である。さらに、フラッシュメモリチップ130 50 のライト単位が大きい場合は、ライト1513のように

複数の計算結果をまとめてライトすることができる。これは、フラッシュメモリチップ130へのライト回数を削減し、フラッシュメモリチップ130の劣化を遅らせる効果がある。なお、ライト1510、1513でフラッシュメモリチップ130にライトする内容は、ICカードチップ150が出力した計算結果そのものに限定されず、図7のステップ715でホスト機器220に返すセキュリティ処理結果またはその一部であってもよい。この場合、図7のステップ714またはその一部は、ステップ712の中で実行されることになる。

【0062】図16は、ホスト機器220がセキュリテ ィ処理結果リードコマンドをMMC110に発行してか ら、MMC110がセキュリティ処理結果を出力するま での過程(図7のステップ713~715)において、 MMC110の外部端子の信号波形、CPU121によ るフラッシュメモリチップ130へのアクセスをシンプ ルに表したものである。図16において、時間の方向は 左から右にとる。一番上の行はフラッシュメモリチップ 130へのアクセス内容である。上から二行目の行から 下の行に向かって、VCC1端子144、CMD端子1 42、CLK1端子145、DAT端子147で観測さ れる信号を表す。また、横方向の破線はそれぞれの信号 の基準 (L レベル) を表す。図16を参照して、ホスト 機器220がセキュリティ処理結果リードコマンドをM MC110に発行してから、MMC110がセキュリテ ィ処理結果を出力するまでの過程を説明する。まず、ホ スト機器220はCMD端子142にセキュリティ処理 結果リードコマンドを送信する(1601)。次に、ホ スト機器220はCMD端子142からセキュリティ処 理結果リードコマンドのレスポンスを受信する(160 2)。このレスポンスは、MMC110がコマンドを受 信したことをホスト機器220に伝えるものであり、セ キュリティ処理結果ではない。次に、MMC110はD AT端子147をLレベルにセットする(1603)。 MMC110は、これによりビジー状態であることをホ スト機器220に示す。次に、CPU121は、フラッ シュメモリチップ130のセキュリティ処理バッファ領 域(図21の2114)から、ICカードチップ150 が出力した計算結果をリードする(1604)。 CPU 121は、これをもとにセキュリティ処理結果を構築 し、MMC110がDAT端子147にセキュリティ処 理結果を出力する(1605)。なお、図7のステップ 714またはその一部が、ステップ712の中で実行さ れている場合、ステップ1604ではフラッシュメモリ チップ130のセキュリティ処理バッファ領域(図21 の2114)からセキュリティ処理結果またはその一部 をリードする。なお、フラッシュメモリチップ130の セキュリティ処理バッファ領域 (図21の2114) を 利用しないでセキュリティ処理結果を構築する場合、ス テップ1604は必要ない。

【0063】MMC110の製造者や管理者は、セキュリティシステムのユーザにMMC110を提供する前やそのユーザが所有するMMC110に問題が発生した時に、MMC110に内蔵されたICカードチップ150に様々な初期データを書きこんだり、ICカードチップ150のテストをおこなったりする必要がある。MMC110の製造者や管理者によるこれらの操作の利便性を高めるために、MMC110は、ICカードチップ150の外部端子をMMC外部端子140に割りつけるインクフェース機能を持つ。これにより、図3~図6で示したようなICカードチップ150へのアクセス信号を、MMC外部端子140から直接送受信できる。このようなMMC110の動作モードを、MultiMediaCard仕様に準拠した動作モードと区別して、以下、15インタフェース直通モードと呼ぶ。

【0064】インタフェース直通モードについて詳細に説明する。図17は、ICカードチップ150の外部端子をMMC外部端子140に割りつけるときの対応関係の一例を表している。この例では、RST端子152を0CS端子141に割り付け、GND2端子155をGND1端子143、146に割り付け、VCC2端子151をVCC1端子144に割り付け、CLK2端子153をCLK1端子145に割り付け、I/O端子157をDAT端子147に割り付ける。このとき、CS端子141とCLK1端子145は入力端子、DAT端子147は入出力端子として機能する。

【0065】MMC110は、特定のメモリカードコマ

ンドを受信すると、動作モードをインタフェース直通モードへ移したり、インタフェース直通モードからMul 1 tiMediaCard仕様に準拠した動作モードに戻すことができる。以下、動作モードをインタフェース直通モードへ移すメモリカードコマンドを直通化コマンド、動作モードをインタフェース直通モードから通常の状態に戻すメモリカードコマンドを復帰コマンドと呼 35 ぶ。図1を参照して、MMCI/F制御回路123は、VCC2制御回路126、CLK2制御回路127、ICカードI/F制御回路128と接続されており、MMC110がホスト機器220から直通化コマンドを受信すると、CPU121の指示により図17で示した端子40 割り付けをおこなう。MMC110がホスト機器220から復帰コマンドを受信すると、CPU121の指示により図17で示した端子割り付けを解除し、MMC11

45 【0066】インタフェース直通モードでは、ホスト機器220が1Cカードチップ150に直接アクセスできるため、セキュリティの観点からインタフェース直通モードを利用できるのは限られた者だけにする必要がある。そこで、直通化コマンドの発行には、一般のユーザ50 に知られないパスワードの送信を必要とする。正しいパ

0はMultiMedia Card 仕様に準拠した動作

モードに戻る。

スワードが入力されないとインタフェース直通モードは 利用できない。

【0067】図18は、ホスト機器220が、MMC1 10の動作モードをMultiMediaCard仕様 に準拠した動作モードからインタフェース直通モードに 移し、ICカードチップ150に直接アクセスし、その 後、MMC110の動作モードを再びMultiMed iaCard仕様に準拠した動作モードに戻すまでの処 理のフローチャートを表している。ホスト機器220は 処理を開始し(1801)、まずMMC110に直通化 コマンドを発行する(1802)。MMC110は、直 通化コマンドで送信されたパスワードが正しいかチェッ クする(1803)。正しければステップ1804に移 り、間違っていれば処理は終了する(1810)。ステ ップ1804では、CPU121は、ICカードチップ 150をコールドリセットする。そして、図17で示し た端子割り付けをおこないインタフェースを直通化する (1805)。この時点から、ホスト機器220はIC カードチップ150に直接アクセスする(1806)。 ホスト機器220がICカードチップ150への直接ア クセスを終了し、MMC110の動作モードを再びMu l t i Me d i a C a r d 仕様に準拠した動作モードに 戻すときは、MMC110に復帰コマンドを発行する (1807)。すると、CPU121は図17で示した 端子割り付けを解除し、MMC110はMultiMe diaCard仕様に準拠した動作モードに戻る(18 08)。そして、CPU121は、ICカードチップ1 50を非活性化する(1809)。以上で、処理は終了 する(1810)。

【0068】図19は、図18のステップ1801~1806の過程において、MMC110および1Cカードチップ150の外部端子の信号波形をシンプルに表したものである。図19において、時間の方向は左から右にとる。上の行から下の行に向かって、VCC1端子144、CMD端子142、CLK1端子145、DAT端子147、VCC2端子151、RST端子152、CLK2端子153、I/O端子157で観測される信号を表す。また、横方向の破線はそれぞれの信号の基準(Lレベル)を表す。1905は、図3のコールドリセットの信号波形を示す。モード移行時刻1906は、動作モードがインタフェース直通モードに移る時刻を表す。

【0069】図19を参照して、ホスト機器220がMMC110の動作モードをMultiMediaCard仕様に準拠した動作モードからインタフェース直通モードに移しICカードチップ150に直接アクセスする過程を説明する。なお、MMC110のVCC1端子144には3V(VCC2端子151の標準電圧)が供給されている。ホスト機器220がCMD端子142に直通化コマンドを入力すると(1901)、CMD端子1

42から直通化コマンドのレスポンスが出力される(1 902)。このレスポンスは、MMC110がコマンド を受信したことをホスト機器220に伝えるものであ る。次に、ホスト機器220はDAT端子147にパス ワードを入力する(1903)。パスワード入力後、M MC110はDAT端子147にLレベルを出力し(1 904)、ビジー状態であることをホスト機器220に 示す。ビジー状態の間に、CPU121は、ICカード チップ150をコールドリセットする(1905)。そ 10 して、モード移行時刻1906において、動作モードを インタフェース直通モードに移す。このときに、DAT 端子147はLレベルからハイインピーダンス状態にな る。これにより、ホスト機器220はビジー状態の解除 を知ることができる。この時点から、ホスト機器220 15 は I Cカードチップ 1 5 0 に直接アクセスする。例え ば、CLK1端子145にクロックを供給すると(19 07)、CLK2端子153にそのクロックが供給され る (1908)。また、DAT端子147にICカード コマンドを送信すると(1909)、 I/〇端子157 20 にその I Cカードコマンドが送信される (1910)。 【0070】図20は、図18のステップ1807~1 810の過程において、MMC110およびICカード チップ150の外部端子の信号波形をシンプルに表した ものである。図20において、時間の方向は左から右に 25 とる。上の行から下の行に向かって、VCC1端子14 4、CMD端子142、CLK1端子145、DAT端 子147、VCC2端子151、RST端子152、C LK2端子153、I/O端子157で観測される信号 を表す。また、横方向の破線はそれぞれの信号の基準 (Lレベル)を表す。モード復帰時刻2003は、動作 モードがインタフェース直通モードからMultiMe d i a C a r d 仕様に準拠した動作モードに戻る時刻を 表す。2004は、図6の非活性化の信号波形を示す。 【0071】図20を参照して、ホスト機器220がM 35 MC110の動作モードをインタフェース直通モードか らMultiMediaCard仕様に準拠した動作モ ードに戻す過程を説明する。なお、MMC110のVC C1端子144には3V (VCC2端子151の標準電 圧)が供給されている。ホスト機器220がCMD端子 142に復帰コマンドを入力すると(2001)、CM - D端子142から復帰コマンドのレスポンスが出力され る(2002)。このレスポンスは、MMC110がコ マンドを受信したことをホスト機器220に伝えるもの である。そして、モード復帰時刻2003において、M 45 MC110はDAT端子147にLレベルを出力してピ ジー状態であることをホスト機器220に示し、それと 同時に動作モードをMultiMediaCard仕様 に準拠した動作モードに戻す。ビジー状態の間に、CP U121は、ICカードチップ150を非活性化する

(2004)。そして、MMC110は、DAT端子1

47をハイインピーダンス状態にし(2005)、復帰コマンドの処理が完了したことをホスト機器220に示す。これ以後、ホスト機器220は1Cカードチップ150に直接アクセスできない。ホスト機器220が、CLK1端子145にクロックを供給しながらCMD端子142に何らかのメモリカードコマンドを送信した場合、ICカードチップ150にそのクロック信号(2006)は伝わらない。2001や2002においてホスト機器220がCLK1端子145に供給するクロック信号は、ICカードチップ150のCLK2端子153にも伝わるが、DAT端子147がハイインピーダンス状態であるため、ICカードチップ150がICカードコマンドを誤って認識することはない。

【0072】図21において、セキュリティ処理ステータス領域2116には、ICカードチップ150によるセキュリティ処理の進捗状況を示す情報を格納する。CPU121は、この情報をセキュリティ処理の実行中に更新することができる。例えば、セキュリティ処理の途中でMMC110への電源供給が停止した場合、電源供給再開時にCPU121がこの情報をリードして参照すれば、セキュリティ処理を中断した段階から再開することができる。

【0073】本発明の実施形態によれば、メモリカード外部からICカードチップの駆動クロックを直接供給しないため、ICカードチップの処理時間を正確に計測できず、また、処理の実行タイミングや順序の検出が困難になる。さらに、異常な駆動クロックを供給することができず、演算エラーを発生させるのが困難になる。したがって、タイミング解析、電力差分解析、故障利用解析攻撃法に対するセキュリティが向上する。

【0074】本発明の実施形態によれば、メモリカード外部からICカードチップの制御方式を自由に設定できる。例えば、高速処理が要求されるならば、ICカードチップの駆動クロックの周波数を高くした制御方式を設定し、低消費電力が要求されるならば、ICカードチップの駆動クロックの周波数を低くしたり、ICカードチップの駆動クロックを適度に停止させる制御方式を設定することができる。したがって、セキュリティシステムの要求する処理性能に柔軟に対応したセキュリティ処理が実現できる。

【0075】本発明によれば、ICカードチップによるセキュリティ処理に必要なデータや、ICカードチップを管理するための情報を、フラッシュメモリに保持することができる。したがって、セキュリティ処理の利便性を向上させることができる。

【0076】本発明の実施形態によれば、MMCの製造者や管理者が、MMC内部のICカードチップに直接アクセスすることができる。したがって、MMC内部のICカードチップの初期化やメンテナンスを、従来のICカードと同様な方法で実現できる。

【0077】本発明の実施形態によれば、フラッシュメモリチップを備えたMMCに、セキュリティ機能を追加する場合、セキュリティ評価機関の認証を予め受けたICカードチップ追加搭載することによって、セキュリティ評価機関によるMMCの認証が不要となるため、MMCの開発期間又は製造期間が短縮する。

【0078】本発明を適用したMMC110は、高度な 情報セキュリティが必要とされる銀行取引、クレジット 決済、コンテンツ配信など多様な電子商取引サービスに 10 適用することができる。ユーザにとっては、これらの多 様なサービス毎に異なるMMC110を持つよりも、1 枚で複数のサービスが利用できるMMC110を持つほ うが便利である。1枚のMMC110を複数のサービス に利用することを考えたとき、一般にサービス毎にその 15 事業者は異なるため、MMC110に内蔵されたICカ ードチップ150の内部では、複数のサービス事業者が 各自のサービス用に設計開発したセキュリティ処理プロ グラムが共存することになる(以下、ICカードチップ 150内のセキュリティ処理プログラムをICカードア ブリケーションと呼ぶ)。したがって、ICカードチッ プ150には、サービスを利用するユーザが複数のIC カードアプリケーションから使用したいものを選択でき る機能(アプリケーション選択機能)や、複数のICカ ードアプリケーションが互いに干渉して誤動作を起こし 25 たり秘密情報が解読されたりしないようにする機能(フ ァイヤウォール機能)が必要となる。そこで、ICカー ドチップ150内に、アプリケーション選択機能やファ イヤウォール機能を持つオペレーティングシステム(以 下、ICカードOSと呼ぶ。)を設置し、各ICカード 30 アプリケーションは、その上で実行可能なプログラムと して実装する。ICカードOSとしては、MULTOS (MULTOSはMondex Internatio nalLimitedの登録商標である。)や、Jav aCardの仮想マシン (JavaCardはSun 35 Microsystems株式会社の登録商標であ

る。)などを適用することが望ましい。 【0079】ICカードOS上で実行可能なプログラム は一般にICカード内のEEPROMに格納されるが、 本発明では、ICカードアプリケーションのプログラム

40 はICカードチップ150内のEEPROM162に格納されるだけでなく、プログラムの一部がフラッシュメモリチップ130にも格納される。これにより、1つのICカードアプリケーションが消費するEEPROM162の畳を削減することができ、ICカードチップ150に搭載可能なICカードアプリケーションの数を増や

15 0に搭載可能なICカードアプリケーションの数を増やすことができる。よって、ユーザは1枚のMMC110でより多くのサービスを利用できる。

【0080】以下、図27~図37を参照しながら、I Cカードアプリケーションのプログラムの一部をフラッ 50 シュメモリチップ130に格納したMMC110のアプ リケーション管理機能について詳しく説明する。

【0081】図27は、ICカードチップ150の機能 的構成を中心にして、MMC110の内部構成を示した ものである。 Г Сカードインタフェース 171は、 Г С カードチップ150の外部端子(VCC2、RST、C LK2、GND2、I/O)、シリアルインタフェース 161、1Cカードコマンド/レスポンスの送受信を制 御するプログラムをまとめて表したものである。ICカ ードOS172は、上で述べたICカードOSを表し、 ICカードインタフェース171を通して外部から受信 したICカードコマンドに応じて、ICカードアプリケ ーションの選択をおこなう。また、選択されたICカー ドアプリケーションへコマンドデータの引き渡しをおこ ない、選択されたICカードアプリケーションから受け 取った処理結果データに基づいてICカードレスポンス 作成し、ICカードインタフェース171を通して外部 へ送信する。アプリケーションA173、アプリケーシ ョンB174、アプリケーションC175は、それぞれ ICカードOS172の上で実行可能なプログラムとし て実装されたICカードアプリケーションであり、ユー ザが利用したいサービスに応じてMMC110外部から メモリカードコマンドで選択することができる (例え ば、銀行取引サービスを利用したい時はアプリケーショ ンA173を、クレジット決済サービスを利用したい時 はアプリケーションB174を、コンテンツ配信サービ スを利用したい時はアプリケーションC175を選択す 'るなど)。次に、アプリケーションA173内のコマン ド解釈部181、モジュール実行部182、モジュール ロード部183、モジュール管理情報184、モジュー ルロード領域185、認証部186およびフラッシュメ モリチップ130内のコマンド処理モジュール187 は、アプリケーションA173のプログラムの一部をフ ラッシュメモリチップ130に格納するという機能を実 現するための機能ブロックやデータを表している。フラ ッシュメモリチップ130に格納されているアプリケー ションA173のプログラムの一部をコマンド処理モジ ュール187と呼ぶ。コマンド処理モジュール187 は、アプリケーションA173が選択された時に使用す ることができる I Cカードコマンド中の1つのコマンド を処理するプログラムモジュールであり、コマンド毎に 用意されている。コマンド処理モジュール18.7はフラ ッシュメモリチップ130に複数格納することができ る。コマンド処理モジュール187はフラッシュメモリ チップ130に格納されているときは暗号化されてお り、コマンド処理の内容はアプリケーションA173に 対応するサービスの事業者以外に知られないようになっ ており、アプリケーションA173内で暗号が解かれて モジュールロード領域185にロードされてはじめて実 行が可能となる。各機能ブロックやデータがどのように 作用するかについては、以下の電子取引サービスの具体

例を用いて後で詳しく説明する。

【0082】電子取引サービスの具体例として銀行取引サービスを示す。図28~図30を用いてそのサービスを詳細に説明する。

- 【0083】図28は、MMCとのインタフェース持つ 05 携帯端末を利用してユーザが銀行取引サービスを実行す るシステムの構成を表している。ホスト機器220は、 MMCとのインタフェースを持つ携帯端末であり、ホス トインタフェース223を通してMMC110にコマン 10 ドによってアクセスする。銀行取引サーバ2830は、 ユーザの銀行口座へのアクセスを提供し、ユーザからの 指示に応じて銀行取引を実行する。ホスト機器220は 通信手段2813を持つ。通信手段2813は、ホスト 機器220がネットワーク2820を通して銀行取引サ 15 一バ2830に接続して情報交換をおこなう際の通信処 理をおこなう。ホスト機器220は、CPU2811を もつ。 CPU2811は、ホストインタフェース223 や通信手段2813を制御し、MMC110や銀行取引 サーバ2830との間で情報交換をおこなう。ホスト機 20 器220は情報表示手段2814を持つ。情報表示手段 2814は、CPU2811により制御され、銀行取引 に関する情報をユーザに表示する。ホスト機器220は ユーザ入力手段2812を持つ。ユーザ入力手段281 2から入力されたデータはCPU2811で処理され 25 る。ユーザは、ユーザ入力手段2812を用いてユーザ 認証のための暗証番号を入力したり、所望の銀行取引
- (残高照会、振込みなど)を指示する。 【0084】図29および図30は、図28のシステム において銀行取引サービスを実行するときの手順を示し 30 たフローチャートである。ここでは簡単のため、エラー 発生時の処理フローを省略する。まず、ユーザは、MM C110を利用したセキュリティ処理をおこなうため、 第1PIN(第1の暗証番号)によってMMC110か ら認証されなければならない。ホスト機器220は、ユ 35 ーザがユーザ入力手段2812から入力した第1PIN をMMC110へ送信するため、第1PIN検証コマン ドを発行する (2901)。 MMC110は、内部の I Cカードチップ150に第1PIN検証のためのICカ ードコマンドを送信し、受信した第1PINが正しいか 40 を検証する(2902)。検証が成功すると、銀行取引 サービスに対応したICカードアプリケーションによる セキュリティ処理の利用が許可される。そこで、ホスト 機器220は、MMC110に銀行取引アプリケーショ ン選択コマンドを発行する(2903)。MMC110 45 は、内部の I Cカードチップ 1 5 0 にアプリケーション 選択のためのICカードコマンドを送信し、銀行取引サ ーピスに対応したICカードアプリケーションを利用可 能な状態にする(2904)。次に、ホスト機器220

は、銀行取引サーバ2830に銀行取引開始要求のメッ

セージを送信する(2905)。銀行取引サーバ283

0は、認証局が発行したサーバ証明書(サーバ公開鍵を 含む)をホスト機器220に送信する(2906)。ホ スト機器220は、サーバ証明書を検証するため、サー バ証明書のハッシュ値を計算する(2907)。そし て、ホスト機器220は、MMC110に署名検証コマ ンドを発行して、そのハッシュ値とサーバ証明書につけ られた認証局による署名を送信する(2908)。MM C110は、内部のICカードチップ150に署名検証 のためのICカードコマンドを送信し、受信した署名が 正しいかを認証局の公開鍵を用いて検証する(290 9)。次に、ホスト機器220は、MMC110に乱数 発生コマンドを発行する(2910)。MMC110 は、内部のICカードチップ150に乱数発生のための ICカードコマンドを送信する。ICカードチップ15 0は乱数を発生し、それをステップ2914のために一 時的に保持する(2911)。そして、ホスト機器22 0は、サーバ証明書からサーバ公開鍵を抽出し(291 2)、MMC110に暗号化コマンドを発行してサーバ 公開鍵を渡す(2913)。MMC110は、内部のI Cカードチップ150に暗号化のためのICカードコマ ンドを送信し、ステップ2911で発生した乱数をサー バ公開鍵で暗号化させ、ホスト機器220に返す(29 14)。ホスト機器220は、暗号化した乱数と、認証 局が発行したユーザ証明書(ユーザ公開鍵を含む)を銀 行取引サーバ2830に送信する(2915)。銀行取 引サーバ2830は、サーバ秘密鍵で暗号化乱数を復号 して乱数を取得し、ユーザ証明書を認証局の公開鍵を用 いて検証し、ユーザ証明書の検証が成功すれば、そこか らユーザ公開鍵を抽出し、取得した乱数をユーザ公開鍵 で暗号化する(2916)。そして図30に移って、銀・ 行取引サーバ2830は、ユーザ公開鍵で暗号化した乱 数をホスト機器220に送信する(3001)。ホスト 機器220はこの暗号化乱数を受信する(3002)。 そして、ホスト機器220は、銀行取引サーバ2830 が本物かどうかを知るため暗号化乱数から乱数を復元で きるかを調べる。そこで、MMC110に復号・比較コ マンドを発行して、暗号化乱数を送信する(300 3)。MMC110は、内部のICカードチップ150 に復号・比較のためのICカードコマンドを送信する。 ICカードチップ150はユーザ秘密鍵で暗号化乱数を 復号し、ステップ2911で発生した乱数と比較し、一 致したかどうかの結果を返す(3004)。ホスト機器 220は、MMC110から乱数が一致したことを示す 応答を受け取ると、情報表示手段2814を用いてユー ザに銀行との取引内容を指示するよう求める。ユーザは ユーザ入力手段2812から取引内容を指示する。そし て、ホスト機器220は、指示された取引内容(残高照 会、振込みなど)を銀行取引サーバ2830に送信する (3005)。銀行取引サーバ2830は、受信した取 引内容が本当にユーザからのものかを確認するため、取

引内容を記した銀行取引契約書を作成し、作成した銀行 取引契約書へのユーザの署名を求めるため、作成した銀 行取引契約書をホスト機器220に送信する(300 7)。ホスト機器220は、受信した銀行取引契約書を 05 情報表示手段2814に表示する(3008)。そして ユーザに内容確認および署名を求める。ユーザは、内容 が正しいことを確認したならば、MMC110を利用し てユーザ秘密鍵による銀行取引契約書への電子的な署名 をおこなう。MMC110は署名処理の実行を許可する 10 前に、第2のPINによって再度ユーザを認証する。ユ ーザはユーザ入力手段2812から第2PINを入力す る。ホスト機器220は、入力された第2PINをMM C110へ送信するため、第2P1N検証コマンドを発 行する(3009)。MMC110は、内部のICカー 15 ドチップ150に第2PIN検証のためのICカードコ マンドを送信し、受信した第2PINが正しいかを検証 する(3010)。検証が成功すると、ユーザ秘密鍵に よる署名処理の利用が許可される。ホスト機器220 は、銀行取引契約書への署名を作成するために銀行取引 契約書のハッシュ値を計算する(3011)。そして、 ホスト機器220は、MMC110に署名作成コマンド を発行して、そのハッシュ値を送信する(3012)。 MMC110は、内部のICカードチップ150に署名 作成のためのICカードコマンドを送信し、ハッシュ値 とユーザ秘密鍵により署名を作成する(3013)。ホ スト機器220は、作成した署名をつけた銀行取引契約 書を銀行取引サーバ2830に送信する(3014)。 銀行取引サーバ2830は、受信した銀行取引契約書に つけられた署名を、図29のステップ2916で取得し 30 たユーザ公開鍵を用いて検証する(3015)。検証が 成功すれば、その取引内容は本物のユーザが指示したも のであることが証明され、銀行取引サーバ2830は、 指示された銀行取引の処理を実行する(3016)。処 理が完了したら、銀行取引サーバ2830は、完了通知 35 のメッセージをホスト機器220に送信する(301 7)。ホスト機器220は、完了通知のメッセージを受 信して情報表示手段2814にそれを表示し、ユーザに 取引の完了を通知する(3018)。以上が、銀行取引 サービスの実行手順である。

- 40 【0085】図27において、例えば、アプリケーションA173が、以上の銀行取引サービスを実行するためのICカードアプリケーションであるとする。以下、銀行取引サービスを例にして、アプリケーションA173のプログラムの一部をフラッシュメモリチップ130に45 格納するという機能について具体的に説明していく。
- 【0086】図31は、図27のコマンド処理モジュール187がフラッシュメモリチップ130のどこに格納されるかを詳細に示したものである。アプリケーションA用コマンド処理モジュール群3111は、銀行取引サービスの実行手順においてMMC110内の1Cカード

チップ150に送信されるICカードコマンドを処理す るためのコマンド処理モジュール187を、複数まとめ たものである。図32は、アプリケーションA用コマン ド処理モジュール群3111の内容を示している。銀行 取引サービスでは7つの1Cカードコマンドが使用され るため、7つのコマンド処理モジュール187が含まれ ている。第1PIN検証処理モジュール3201は、図 29のステップ2902で使用する。署名検証処理モジ ュール3202は、図29のステップ2909で使用す る。乱数発生処理モジュール3203は、図29のステ ップ2911で使用する。暗号化処理モジュール320 4は、図29のステップ2914で使用する。復号・比 較処理モジュール3205は、図30のステップ300 4で使用する。第2PIN検証処理モジュール3206 は、図30のステップ3010で使用する。署名作成処 理モジュール3207は、図30のステップ3013で 使用する。これらのコマンド処理モジュール187は識 別番号1から7によって管理され、アプリケーションA 用コマンド処理モジュール群3111の中から必要なも のを引き出すことができる。図31において、アプリケ ーションB用コマンド処理モジュール群3112、アプ リケーションC用コマンド処理モジュール群3113 も、アプリケーションA用コマンド処理モジュール群3 111と同様に、それぞれのICカードアプリケーショ ンに対応する電子取引サービスで使用されるICカード コマンドを処理するためのコマンド処理モジュール18 7を、複数まとめたものである。

【0087】コマンド処理モジュール187を使用する ためにはICカードチップ150ヘロードする必要があ る。このロード処理は、図13のステップ1306や1 307で示した環境設定の一種である。そのため、アプ リケーションA用コマンド処理モジュール群3111、 アプリケーションB用コマンド処理モジュール群311 2、アプリケーションC用コマンド処理モジュール群3 113といったコマンド処理モジュール群は、図31の ように、フラッシュメモリチップ130の管理領域21 10における1Cカード環境設定情報領域2112に格 納する。管理領域2110以外の領域(ホストデータ領 域2115)に格納してもよいが、不正に改ざんされた りすることを防止するため、管理領域2110に格納す るほうが望ましい。モジュールデータ領域3110は、 各コマンド処理モジュール群を格納するために、ICカ ード環境設定情報領域2112内に用意された領域であ る。なお、図31では図21に示した領域のうち、説明 に必要ないものを省略している。

【0088】次に、ICカードチップ150に登録されたアプリケーションA173の中にあるモジュールロード領域185について詳細に説明する。図33は、ICカードチップ150内のメモリ資源(ROM159、RAM160、EEPROM162)の詳細な内部構成を

示したものである。まず、ROM159には、ICカー ドOSプログラム3341、ICカードインタフェース 制御プログラム3342が含まれる。ICカードOSプ ログラム3341は、ICカードOS172を機能させ 05 るためにCPU15.8で実行されるプログラムである。 ICカードインタフェース制御プログラム3342は、 ICカードインタフェース171を制御するためにCP U158で実行されるプログラムである。次に、RAM 160には、ICカードOSワーク領域3351、アプ 10 リケーションワーク領域3352が含まれる。ICカー ドOSワーク領域3351は、CPU158がICカー ド〇Sプログラム3341を実行するときに使用するメ インメモリである。アプリケーションワーク領域335 2は、ICカードOS172によって選択されたICカ 15 ードアプリケーション (173、174、175など) が使用するメインメモリである。次に、EEPROM1 62には、ICカードOS設定情報3310、アプリケ ーションA173、アプリケーションB174、アプリ ケーションC175などが含まれる。ICカードOS設 20 定情報3310は、ICカードOS172が、状況に応 じてICカードOSプログラム3341によって既定さ れた機能を変化させたり、新しい機能を追加するために 使用する書き換え可能な情報である。各ICカードアプ リケーション(173、174、175など)は、さら 25 に3つの構成要素からなる。図33では、アプリケーシ ョンA173についてそれらの構成要素(アプリケーシ ョンAメインプログラム3320、モジュールロード領 域185、モジュール管理情報184)を示す。アプリ ケーションAメインプログラム3320は、アプリケー 30 ションA 1 7 3 の 4 つの機能ブロック (図 2 7 におけ る、コマンド解釈部181、モジュール実行部182、 モジュールロード部183、認証部186)を含み、I CカードOS172上で実行されるプログラムである。 モジュールロード領域185は、アプリケーションA用 35 コマンド処理モジュール群3111の7モジュール(3 201~3207) から実行したいものをロードするた めの領域であり、1つ以上のモジュールを格納できるサ イズが確保されている。例えば、3つの領域(第1領域 3331、第2領域3332、第3領域3333) が用 40 意されている。この場合、7モジュールのうち最大3モ ジュールまでロードすることができる。よって、EEP ROM162において、アプリケーションA173に消 費される領域サイズをできるだけ小さくしたいならば、 モジュールロード領域185は、1モジュールを格納で 45 きるサイズを確保すればよい。次に、モジュール管理情 報184は、各コマンド処理モジュール(3201~3 207) をモジュールロード領域185にロードすると きなどに使用されるデータであり、アプリケーションA 173内でその内容を参照したり更新したりすることが

50 できる。また、MMC110内のコントローラチップ1

20がその内容を読み出すこともできる。さらに、アプリケーションA173の改訂などにおいて、そのコマンド処理モジュール(3201~3207)を更新する際には、コントローラチップ120がその内容を書き換えることもできる。

【0089】図35は、アプリケーションA173のモ ジュール管理情報184の内容を示している。モジュー ル管理情報184は、ロード管理情報3510とロード 領域情報3520から構成される。ロード管理情報35 10は、アプリケーションA用コマンド処理モジュール 群3111の各モジュール (3201~3207) に関 する情報であり、ロード領域情報3520は、モジュー ルロード領域185の各領域(3331~333)に 関する情報である。ロード管理情報3510は、各モジ ュールの識別番号(番号3511)とコマンド処理の内 容(処理内容3512)との対応関係を示す情報を含 む。コントローラチップ120がモジュールをロードす る際には、番号3511をコマンド処理モジュール18 7に付してICカードチップ150にロードする。な お、処理内容3512に記載するデータとして、ホスト 機器220から受信したセキュリティ処理要求コマンド のヘッダ部分(コマンドクラス番号や命令コード番号な ど)を利用すれば、コントローラチップ120によるモ ジュール選択がしやすい。ロード管理情報3510は、 各モジュールのプログラムサイズ(サイズ3513) (単位はバイト)を含み、モジュールロード領域185 の各領域に格納可能なサイズかどうかを判定できるよう にしている。ロード管理情報3510は、各モジュール のロード状態(状態3514)を含む。図35では、例 えば、第1PIN検証処理モジュール3201がモジュ ールロード領域185の第2領域3332にロードされ ており、乱数発生処理モジュール3203はモジュール ロード領域185にロードされていないことを示してい る。ロード管理情報3510は、その時点でロードされ ている各モジュールの改訂番号(使用版3515)を含 む。ロード管理情報3510は、各モジュールの最新の 改訂番号(最新版3516)を含む。モジュールの更新 時にMMC110のホスト機器220から最新の改訂番 号が知らされ、そのモジュールの最新版3516の値が その番号に更新される。その際、更新するモジュール以 40 外のモジュールの最新版3516の値も同時に更新して もよい。ロード管理情報3510は、ロード条件351 7を含む。ロード条件3517は、モジュールをロード するときに、ロードを許可するかどうかをアプリケーシ ョンA173が判定するための条件であり、その使用版 3515や最新版3516の値に基づく。図35では、 例えば、署名検証処理モジュール3202は改訂番号に 関係なくロードを許可し、暗号化処理モジュール320 4 は最新版のみロードを許可し、復号・比較処理モジュ ール3205は使用版3515の値が1. 0以上ならば

ロードを許可することを意味する。次に、ロード領域情報3520は、モジュールロード領域185の各領域(3331~333)の容量サイズ3521(単位はバイト)を含む。これは、各領域(3331~333)が、サイズ3521の値より大きなサイズのモジュールをロードできないことを示すための情報である。例えば、第2領域3332には320バイトの容量しかないため、復号・比較処理モジュール3205(サイズが388バイト)はロードすることが許可されない。ロード領域情報3520は、領域識別番号3522を含む。これは、コントローラチップ120が、コマンド処理モジュール187をロードする領域を指定するのに使用する

【0090】図34は、コントローラチップ120によ 15 るコマンド処理モジュール187のロード、およびIC カードチップ150によるセキュリティコマンドの実行 の手順を示すフローチャートである。まず、コントロー ラチップ120はモジュール管理情報184を使用して モジュールをロードするかを判断する (3401)。こ 20 のステップ3401は、図13ではステップ1306に 相当する。コントローラチップ120が、必要なモジュ ールがすでにロードされていることを知っているなら ば、ステップ3412に移ってよい。これは、図13で はステップ1306から1308への遷移に相当する。 25 一方、コントローラチップ120が、モジュール管理情 報184を使用してモジュールをロードする必要がある かを判断したいならば、ステップ3402に遷移する。 これは、図13ではステップ1307 (環境設定の実 行)への遷移に相当する。ステップ3402では、コン トローラチップ120は、環境設定のためのICカード コマンドとして、モジュール管理情報184のリードコ マンドをICカードチップ150に発行する。ICカー ドチップ150のICカードOS172は、アプリケー ションA173にこのコマンドの処理権を渡す。アプリ 35 ケーションA173は、コマンド解釈部181でこのコ マンドを解釈し、ICカードOS172を通してモジュ ール管理情報184をコントローラチップ120へ送信 する(3403)。コントローラチップ120は、モジ ュール管理情報184の内容を調べ、所望のコマンド処 理モジュール187が、モジュールロード領域185に ロードされているかを確認する(3404)。そして、 存在するならばステップ3412に移り、存在しなけれ ばステップ3406に移る(3405)。コントローラ チップ120は、フラッシュメモリチップ130のモジ 45 ュールデータ領域3110から所望のコマンド処理モジ ュール187 (ここでは3201から3407のいずれ か)を読み出す(3406)。そして、コントローラチ ップ120は、環境設定のためのICカードコマンドと して、モジュールロードコマンドを I Cカードチップ1

50に発行し、読み出したモジュール、モジュール識別

番号(ここでは1~7の範囲)、ロード領域番号(ここ では1~3の範囲)を送信する(3407)。 I Cカー ドチップ150のICカードOS172は、アプリケー ションA173にこのコマンドの処理権を渡す。アプリ ケーションA173は、コマンド解釈部181でこのコ マンドを解釈し、認証部186において、受信したコマ ンド処理モジュール187が適正かを判定する(340 8)。具体的には、コマンド処理モジュール187にか けられた暗号を解き、実行可能なデータ形式であるか、 サイズが適当であるかなどを調べる。そのため、認証部 186は、モジュールにかけられた暗号を解くためのモ ジュール鍵を持つ。望ましくは、モジュールの改ざん防 止のために電子署名を適用する。すなわち、アプリケー ションA173に固有の秘密鍵(アプリケーション秘密 鍵)とそれに対応する公開鍵(アプリケーション公開 鍵) を用意し、コマンド処理モジュール187、また は、その暗号化前の実行可能形式データにアプリケーシ ョン秘密鍵によって電子署名を付けておき、認証部18 6 でアプリケーション公開鍵によってその署名を検証す るようにする。この場合、認証部186は、アプリケー ション公開鍵も持つ。ステップ3408において、コマ ンド処理モジュール187が適正でないならば、ステッ プ34.11に移り、ICカードチップ150は、ロード 結果が失敗であることをコントローラチップ120に返 す。コマンド処理モジュール187が適正ならば、アプ リケーションA173のモジュールロード部183は、 モジュールロード領域185の指定された領域(333 1、3332、3333のいずれか) にライトし (34 09)、モジュール管理情報184の状態3514を更 新する(3410)。そして、ICカードチップ150 は、ロード結果が成功であることをコントローラチップ 120に返す(3411)。そして、コントローラチッ プ120は、ステップ3412~3416にわたって、 アプリケーションA173によるセキュリティコマンド 処理を実行する。これは、図13のステップ1309に 相当する。まず、コントローラチップ120は、ICカ ードチップ150にセキュリティコマンドを発行する (3412)。セキュリティコマンドとは、図29にお けるステップ2901、2908、2910、291 3、図30におけるステップ3003、3009、30 12のいずれかで発行するコマンドに応じて、MMC1 10内部で発行されるICカードコマンドである。IC カードチップ150内のアプリケーションA173のコ マンド解釈部181は、モジュール管理情報184によ り、そのコマンドに対応するコマンド処理モジュール1 87がモジュールロード領域185に存在するかを調査 する(3413)。存在しないならば、処理結果が失敗 であることをコントローラチップ120に返し(341 5)、ステップ3416に移る。存在するならば、モジ ュール実行部182は、モジュールロード領域185か

らそのコマンド処理モジュール187を読み、セキュリティコマンドを処理する(3414)。そして、その処理結果をコントローラチップ120に返す(3415)。コントローラチップ120は、その処理結果を受65信する(3416)。以上が、コントローラチップ120によるコマンド処理モジュール187のロード、およびICカードチップ150によるセキュリティコマンドの実行手順である。

【0091】図36は、フラッシュメモリチップ130 10 に格納されたアプリケーションA173のためのコマン ド処理モジュール187を、ホスト機器220によって 更新する手順を示すフローチャートである。ここで、ホ スト機器220は、アプリケーションA173のモジュ ール更新することを許可されており、上述のアプリケー 15 ション秘密鍵を持っているものとする。また、この手順 においてホスト機器220からMMC110に送信され る新しいコマンド処理モジュールは、その識別番号、サ イズ、改訂番号(それぞれ、図35における番号351 1、サイズ3513、最新版3516に登録されるべき 20 情報)が含まれている。また、この手順に先だって、 I Cカードチップ150では、アプリケーションA173 が選択されているものとする。まず、ホスト機器220 は暗号化乱数発生コマンドを発行する(3601)。M MC110は、ICカードチップ150のアプリケーシ 25 ョンA173の認証部186において、乱数を発生させ (3602)、その乱数を上述のアプリケーション公開 鍵で暗号化させ、暗号化乱数をホスト機器220に送信 する(3603)。ホスト機器220は、アプリケーシ ョン秘密鍵で暗号化乱数を復号し、乱数を復元する(3 30 604)。そして、ホスト機器220は、その乱数と新 しいコマンド処理モジュールを連結したデータを作り、 そのデータにアプリケーション秘密鍵で電子的に署名す る (3605)。ホスト機器220は、MMC110に 検証・ライトコマンドを発行して、その署名付き連結デ 35 一夕を送信する (3606)。MMC110は、ICカ ードチップ150のアプリケーションA173の認証部 186において、アプリケーション公開鍵で連結データ の署名を検証させる(3607)。ステップ3608で は、連結データ内の乱数がステップ3602で発生した 40 乱数と一致するかを比較する。ステップ3607での検 証が成功し、かつそれらの乱数が一致したならば、受信 した新しいコマンド処理モジュールは正しいものである ことが証明されたので、新しいコマンド処理モジュール を、アプリケーションA用コマンド処理モジュール群3 45 111の中の同じ識別番号のコマンド処理モジュールに 上書きする(3609)。さらに、1Cカードチップ1 50にICカードコマンドを送ることによって、アプリ ケーションA173内のモジュール管理情報184の内 容(図35における番号3511、サイズ3513、最 50 新版3516に登録される情報)も更新する。そして、

ホスト機器220は更新処理を終了する(3610)。 一方、ステップ3607での検証が失敗するか、または 乱数が一致しないならば、コマンド処理モジュールやモ ジュール管理情報184の内容の更新は実行せず、ホス ト機器220は更新処理を終了する(3610)。

【0092】図37は、図34や図36の手順で登場したアプリケーションに固有な3種類の鍵(モジュール鍵、アプリケーション秘密鍵、アプリケーション公開鍵)を説明したものである。モジュール鍵3701は、コマンド処理モジュールにかけられた暗号を解き、実行可能形式に復元するための対称鍵である。アプリケーション秘密鍵3702は、アプリケーション発行者が厳重に管理すべき秘密鍵であり、コマンド処理モジュールの更新手順において乱数の復号、署名の作成に使用される。アプリケーション公開鍵3703は、アプリケーション秘密鍵3702に対応する公開鍵であり、コマンド処理モジュールのロード手順・更新手順において乱数の暗号化、署名の検証に使用される。

【0093】上記では、コマンド処理モジュール187が1つのセキュリティコマンドを処理するプログラムモジュールであると説明されているが、複数のセキュリティコマンドを1つのコマンド処理モジュール187が処理してもよい。

【0094】本発明によれば、ICカードチップによるセキュリティ処理に必要なデータやICカードチップを管理するための情報をフラッシュメモリに保持し、ICカードチップ内のセキュリティ処理プログラムが消費するメモリ資源を節約し、より多くのプログラムを登録することができる。したがって、ユーザの利便性を向上させることができる。

【0095】尚、1つのMMC110が、複数のICカー ドチップ150を備えてもよい。複数のICカードチップ1 50の個々は、異なるアプリケーションプログラムを実行 してもよい。例えば、3つの1Cカードチップ150のう ちの第1のICカードチップ150が、アプリケーション プログラムA173を実行し、3つのICカードチップ150 のうちの第2の1Cカードチップ150が、アプリケーシ ョンプログラム B 174を実行し、3 つの I Cカードチッ プ150のうちの第3のICカードチップ150が、アプリケ ーションプログラムC175を実行するのが好ましい。さ らに、複数の1Cカードチップ150の個々は、異なる者 によって認可又は発行されてもよい。例えば、第1の1 Cカードチップ150は、アプリケーションプログラムA1 73を用いて銀行取引サービスを実現する例えば銀行によ って認可又は発行され、第2の1Cカードチップ150 は、アプリケーションプログラムB174を用いてクレジ ット決済サービスを実現する例えばクレジット会社によ って認可又は発行されるのが好ましい。第3の1Cカー ドチップ150は、アプリケーションプログラムC175を用 いてコンテンツ配信サービスを実現する例えばコンテン

ツプロバイダーによって認可又は発行されてもよいし、第3者(例えば、ICカードチップ150のセキュリティを認可又は保証する機関)によって認可又は発行されてもよい。この場合、銀行、クレジット会社、コンテンツ05プロバイダーや第3者によって認可又は発行された後、MMC110に搭載するのが好ましい。つまり、認可又は発行されたICカードチップ150を、MMC110上に固定し、ICカードチップ150内のインターフェース150~157と、ICカード I/F制御回路128、CLK2制御回路1027、VOC2制御回路126、GND1とを電気的に接続する。

【0096】これまでに述べたMMC110のセキュリ ティ処理においては、ICカードチップ150に送信す るICカードコマンドによって扱うべきデータサイズ 15 が、ICカードチップ150内部で利用可能なワークメ モリの空き容量を越えてしまうと、セキュリティ処理が 実行不能になってしまう可能性がある。例えば、ワーク メモリ(例えば、RAM160のICカードOSワーク領 域3351やアプリケーションワーク領域3352等) の空き容 20 量が100バイトのときに、ICカードコマンドにより 200バイトの暗号文の復号が要求されても処理できな い。このような問題を解決するために、MMC110 は、ICカードチップ150が状況(例えば、ICカー ドコマンドによって要求される処理に必要なメモリ量や ICカードコマンドによって処理すべきデータ量) に応 じて外部に対して能動的に要求を出す機能を搭載する。 以下、その機能について説明する。

【0097】上記の問題を解決するには、まず、ICカ ードチップ150は、セキュリティのためのコマンドを 30 受け取り、その後処理すべきデータ量を算出し、その処 理すべきデータ量がその時点でのワークメモリの空き容 量より大きい又は以上であるかを判断するとよい。比較 すべき空き容量は、コマンドを受け取ってからその都度 計算してもよいし、常時計算しておいてレジスタに保持 35 しておき、その値を利用してもよい。もしそれが空き容 量より大きい又は以上でなければ(空き容量より小さい-又は以下であれば)、コマンドで指示された処理を実行 し、コントローラチップ120にその処理結果を応答と して返す。一方、もしそれが空き容量より大きい又は以 40 上であるならば、状況に応じた要求を含む応答をコント ローラチップ120に返す。その要求の内容としては、 例えば、「たったいま送信したデータをフラッシュメモ リチップ130にライトし、128バイト単位に分割し て送れ」とか、「ホスト機器220は、処理すべきデー 45 夕を128バイト単位に分割して再送信せよ」といった ものが考えられる。コントローラチップ120が、この ような要求にしたがって適当な処理を実行すれば、IC カードチップ150によるセキュリティ処理が実行不能

50 【0098】このような機能は、図23を用いて説明し

になることを防止することができる。

たコンテンツ配信の例にも適用することができる。暗号 化されたコンテンツ2314をセッション鍵によって復 号する手順2324において、コンテンツ2314のデ ータサイズがワークメモリの空き容量より大きい又は以 上であったならば、ICカードチップ150は「ホスト 機器220は、コンテンツ2314を128バイト単位 に分割して再送信せよ」などの要求を含んだ応答を返 す。コンテンツ2314のデータを一括して受け取っ て、その復号処理を実行し、処理結果(成功か失敗か 等)を含んだ応答を返してもよい。これにより、ICカ ードチップ150による復号処理が実行不能になること を防止することができる。 I Cカードチップ150は、 これに加えて、さらに「コントローラチップ120は、 復号したコンテンツをフラッシュメモリチップ130に ライトせよ」という要求を含んだ応答を返してもよい。 そうすれば、ホスト機器220が、コンテンツをフラッ シュメモリチップ130にライトするため、MMC11 0に対してライトコマンドを送信する手間を省くことも できる。

【0099】以下、ICカードチップ150がコントローラチップ120を通じて要求する何らかの処理のことを、「外部処理」と一般化して呼ぶこととする。

【0100】図38を用いてMMC110が外部処理を 実行する手順を詳細に説明する。先ず、コントローラチ ップ120はセキュリティ処理のためのICカードコマ ンドを発行する(3801)。 I Cカードチップ150 はそのコマンドを解析し、外部処理が必要かを判断する (3802)。例えば、前述例のように、ICカードコ マンドで入力されたデータの量とICカードチップ15 0内のワークメモリの空き容量とを比較し、データ量が メモリ容量より大きい又は以上であれば外部処理が必要 と判断し、データ量がメモリ容量より小さい場合は外部 処理が不要と判断する。手順3802の結果、外部処理 が必要ならば、外部処理要求コードを含むレスポンスを 送信する(3803)。外部処理要求コードとは、コン トローラチップ120に外部処理を要求したいというこ とを告知するための符号である。 I Cカードチップ15 0が準拠する ISO7816のコマンド規格によれば、 I/O端子157からシリアルデータとして出力され る、ICカードコマンドのレスポンス信号は、コマンド 処理状況を示す「ステータスワード」と呼ばれる例えば 2バイトの符号化データをその末尾部 (又は前頭部) に 含む。これは主に、コマンド処理結果がエラー (6 X h、XXh (Xはエラー内容に依存))であるか、成功 (90h、00h) であるかを I Cカードチップ外部に 示すために使用される。外部処理要求コードは、このス テータスワードを利用するのが好ましい。すなわち、ス テータスワード=91h、YYhを外部処理要求コード と定義する。ここで、YYhは、外部処理の内容を示し たデータの長さがで YYh (16進数) バイトであるこ

とを予告している。手順3803の次に、コントローラ チップ120は、レスポンスを受信し、その受信したレ スポンスを分析し、外部処理要求コードが含まれるかを 調べる(3804)。外部処理要求コードが含まれてい 05 るならば、外部処理内容を読み出す I Cカードコマンド を発行する(3805)。そして、YYhバイトの外部 処理内容を含む応答データを待つ。 I Cカードチップ 1 50がYYhバイトの外部処理内容を含む応答データを 送信する(3806)と、コントローラチップ120は 10 受信した外部処理内容を分析する(3807)。そし て、コントローラチップ120は、外部処理内容に応じ て、フラッシュメモリチップ130またはホスト機器2 20に対して、上の例で記したような外部処理を指示す る(3808)。フラッシュメモリチップ130または 15 ホスト機器220は、指示された外部処理を実行する (3809)。その後、コントローラチップ120は、 その外部処理の結果を示すデータを作成し(381 0)、ICカードチップ150に結果通知コマンドを発 行して外部処理の結果を送信する(3811)。 I Cカ 20 ードチップ150は、外部処理の結果を分析し、正しく 処理されたか、または、さらなる外部処理が必要かどう かを判断する(3812)。そして、その判断に応じた レスポンスを送信する (3813)。 コントローラチッ プ120は、そのレスポンスを分析する(3814)。

25 そのレスポンス中のステータスワードがエラー (6 X h、XXh)であれば、外部処理はエラーであることを意味する。それが成功 (90h、00h)であれば、外部処理は正常に終了したことを意味する。もし、ステータスワードが外部処理要求コード (91h、YYh)で30 あれば、コントローラチップ120は、手順3805に戻って、次に要求される外部処理内容を読み出す手順から再び始める。

【0101】なお、手順3806において送信する外部 処理内容の表記法としては、コントローラチップ120 35 と I Cカードチップ 150 との間であらかじめ定義され た符号化ルールを利用することが好ましい。符号化ルー ルとしては、例えば、「フラッシュメモリチップ13 0」を01h、「I-Cカードチップ150」を02h、 「直前に送信されたデータ」を11h、「ライト処理せ 40 よ」を22h、「128(80h)バイト単位に分割し て送信せよ」を2380hなどとあらかじめ定義してお く。この場合、一例として、外部処理内容データに01 h. 11h. 22h. 02h. 11h. 23h. 80h という 7 バイトの符号を設定することは、「たったいま 45 送信したデータをフラッシュメモリチップ130にライ トし、それを128バイト単位に分割してICカードチ ップ150に送れ」という内容を意味している。このよ うな符号化ルールは、コントローラチップ120内部に 格納しておいたものを参照してもよいし、フラッシュメ 50 モリチップ130に格納しておき、必要に応じてそこか ら読み出して参照してもよい。

【0102】また、手順3806において送信する外部処理内容が、フラッシュメモリチップ130に対するリード・ライト処理である場合は、外部処理内容のデータ形式をMultiMediaCard仕様に定義されたリード・ライトコマンドと同じ形式にしてもよい。これは、ホスト機器220がMMC110に対して発行するコマンドと同じ構造のデータ形式となるため、コントローラチップ120内部にあるMMCコマンドの分析手段に外部処理内容のデータを直接入力するだけで外部処理(フラッシュメモリに対するリード・ライト処理)が実行できるため、効率的な処理が実現できる。

【0103】また、手順3806において送信する外部処理内容が、ホスト機器220に対して要求する処理である場合は、外部処理内容のデータ形式をMultiMediaCard仕様に定義されたコマンドのレスポンスと同じ形式にしてもよい。そうすれば、ホスト機器220内部にあるMMCレスポンスの分析手段に外部処理内容のデータを直接入力するだけで外部処理が実行できるため、効率的である。

【0104】ホスト機器220が通信機能を持つような機器であるならば、ホスト機器220に対する外部処理として、「遠隔地のサーバにデータを送信せよ」といった内容にすることも可能である。これにより、ホスト機器220内部にあるサーバ通信プログラムの一部を削減できるため、ホスト機器220内部のプログラムメモリを節約できる。

【0105】ホスト機器220がXML(eXtensible Markup Language:拡張可能なマーク付け言語)に対応したブラウザ機能を持つような機器であるならば、ホスト機器220に対する外部処理として、「データをブラウザによってディスプレイに表示せよ」とった内容も可能である。このとき、ICカードチップ150が送信する表示データをXML言語で書かれたものにすれば、ホスト機器220内部で表示データ変換をおこなわなくてもよいため、効率的な表示処理が実現できる。

【0106】本発明によれば、ICカードチップが他のチップに対して能動的に処理を要求することにより、ICカードチップによるセキュリティ処理において、フラッシュメモリやホスト機器など外部のデバイスを有効に活用して、より大きなサイズのデータを処理することができるため、利便性の高いセキュリティシステムを実現することができる。

[0107]

【発明の効果】本発明によれば、ICが実行するためのプログラムやデータ、ICを管理するための情報をIC外部の不揮発性メモリに保持するため、IC内の記憶容量(例えば、ROMやEERROM)が小さい場合にも、ICが多くの処理を実行できるという効果を奏す

る。

【0108】本発明によれば、ICが実行する処理の一部をIC外部のコントローラが実行するため、IC内の記憶容量(例えば、RAM)が小さい場合にも、ICが 05 多くの処理を実行できるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明を適用したMMCの内部構成を示す図である。

【図2】 本発明を適用したMMCのホスト機器の内部 10 構成、およびホスト機器とMMCとの接続状態を示す図である。

【図3】 ICカードチップのコールドリセット時の信号波形を示す図である。

【図4】 ICカードチップのウォームリセット時の信 15 号波形を示す図である。

【図5】 ICカードチップのICカードコマンド処理 時の信号波形を示す図である。

【図6】 ICカードチップの非活性化時の信号波形を示す図である。

20 【図7】 ホスト機器によるMMCへのアクセスを示し たフローチャートである。

【図8】 ICカード制御パラメータとそれに対応する ICカードへの処理内容を示す表である。

【図9】 I Cカードチップに対する第1次I Cカード 25 初期化の詳細なフローチャートである。

【図10】 ICカードチップに対する第2次ICカード初期化の詳細なフローチャートである。

【図11】 非活性状態のICカードチップに対するICカード初期化時の信号波形を示す図である。

30 【図12】 活性状態のICカードチップに対するIC カード初期化時の信号波形を示す図である。

【図13】 ICカードチップによるセキュリティ処理の詳細なフローチャートである。

【図14】 セキュリティ処理要求ライトコマンドを処 35 理するときの信号波形とフラッシュメモリチップアクセ スを示す図である。

【図15】 ICカードチップによるセキュリティ処理 実行時の信号波形とフラッシュメモリチップアクセスの 一例を示す図である。

40 【図16】 セキュリティ処理結果リードコマンドを処理するときの信号波形とフラッシュメモリチップアクセスを示す図である。

【図17】 インタフェース直通モードにおけるMMC 外部端子とICカードチップ外部端子の対応関係を示す 45 図である。

【図18】 インタフェース直通モードへ移行する処理 とインタフェース直通モードから復帰する処理のフロー チャートである。

【図19】 インタフェース直通モードへ移行する処理 50 時の信号波形を示す図である。

【図20】 インタフェース直通モードから復帰する処理時の信号波形を示す図である。

【図21】 フラッシュメモリチップの内部構成を示す 図である。

【図22】 本発明を適用したMMCの内部構成を簡単に示す図である。

【図23】 本発明を適用したMMCをコンテンツ配信 に応用した例を示す図である。

【図24】 本発明を適用したSDカードの内部構成を 簡単に示す図である。

【図25】 本発明を適用したメモリースティックの内部構成を簡単に示す図である。

【図26】 本発明のICカードチップの内部構成を示す図である。

【図27】 本発明を適用したMMCの内部構成を示し、特に1Cカードチップの機能的構成の詳細を含む図である。

【図28】 本発明を適用したMMCを銀行取引サービスに応用した場合の、システム構成を示す図である。

【図29】 本発明を適用したMMCを銀行取引サービスに応用した場合の、取引実行時のフローチャートの前半である。

【図30】 本発明を適用したMMCを銀行取引サービスに応用した場合の、取引実行時のフローチャートの後半である。

【図31】 フラッシュメモリチップの内部構成を示

し、特にICカード環境設定情報領域の詳細を含む図である。

【図32】 コマンド処理モジュール群の一例を示す図である。

05 【図33】 I Cカードチップの中のROM、RAM、 EEPROMの内部構成を示す図である。

【図34】 コマンド処理モジュールのロード手順およびセキュリティコマンドの実行手順のフローチャートである。

10 【図35】 モジュール管理情報の詳細および具体例を 示す図である。

【図36】 コマンド処理モジュールの更新手順のフローチャートである。

【図37】 コマンド処理モジュールのロードや更新に15 使用する鍵の説明を示す図である。

【図38】 ICカードチップの要求に従い、コントローラチップがフラッシュメモリチップやホスト機器に処理を実行させる手順を示すフローチャートである。

【符号の説明】

- 20
 110…MMC、120…コントローラチップ、140

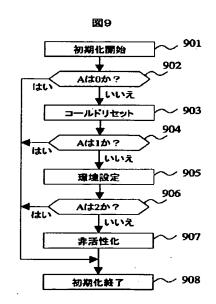
 …MMC外部端子、150…ICカードチップ、151

 …VCC2端子、152…RST端子、153…CLK

 2端子、155…GND2端子、156…VPP端子、157…I/O端子、220…ホスト機器、1405…
- 25 ライトコマンド発行、1906…モード移行時刻、20 03…モード復帰時刻。

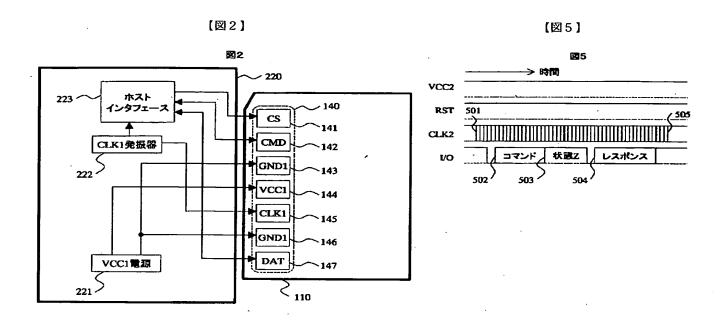
22 1 <u> (121</u> _123_ _122 MMC I/F フラッシュ 141 CS CPU メモリバ 制御田路 フラッシュ 制御回路 メモリ 142 CMD チップ VCC2生成器 143 GND1 CLK0 ₹₁₂₅ 华新岛 144 VCC1 VCC2制御回路 ` 130 CLK2制御回路 ۲₁₂₆ CLKI 120 ICカードI/F制御回路 146 GND1 DAT 151 156 152 153 110 **\ 150**

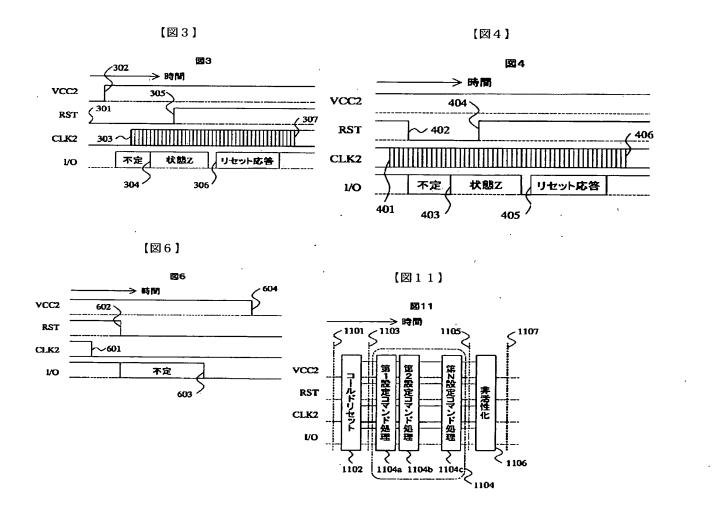
【図1】



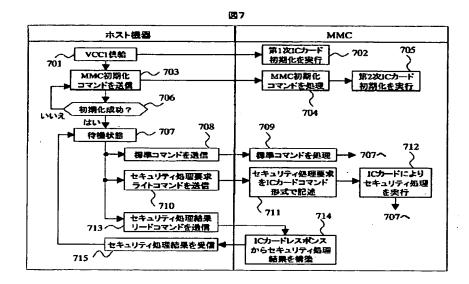
【図9】

- 27 -





【図7】

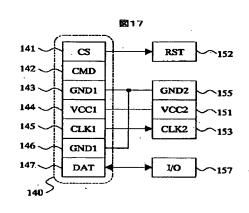


【図8】

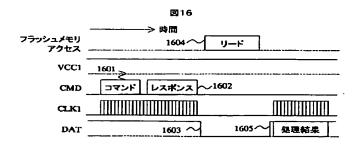
図8

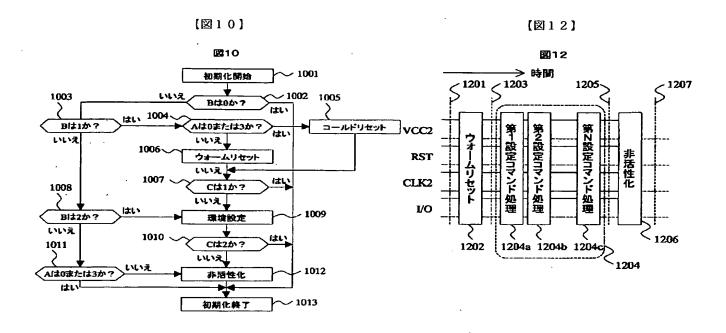
ICカード制御 パラメータ		ICカードに対する処理	
A=0		MMCのパワーオン時に、何もしない	
A=1		MMCのパワーオン時に、リセット	
A=2		MMCのパワーオン時に、リセットと環境設定	
A=3		MMCのパワーオン時に、リセットと環境設定し、非活性化	
B=0		MMCの初期化時に、何もしない	
B=1	C=1	MMCの初期化時に、リセット	
	C=2	MMCの初期化時に、リセットと環境設定	
	C=3	MMCの初期化時に、リセットと環境設定し、非活性化	
B=2	C=2	MMCの初期化時に、環境設定	
	C=3	MMCの初期化時に、環境設定し、非活性化	
B=3		MMCの初期化時に、活性状態ならば、非活性化	
D=0		セキュリティ処理後に、非活性化しない	
D=1		セキュリティ処理後に、非活性化する	

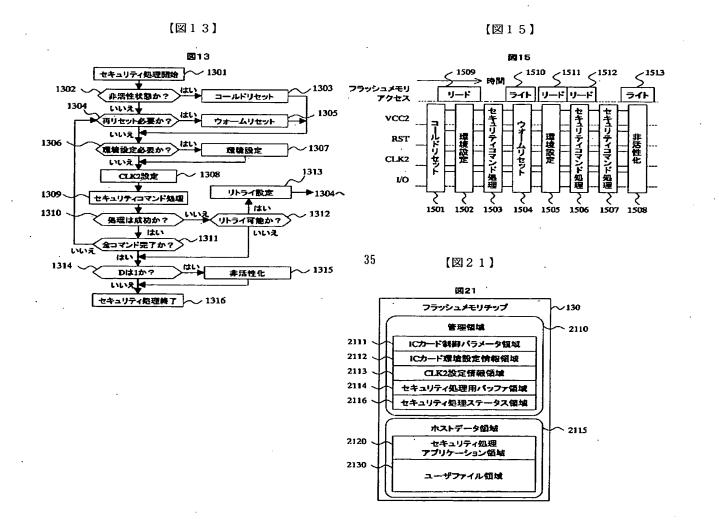
【図17】

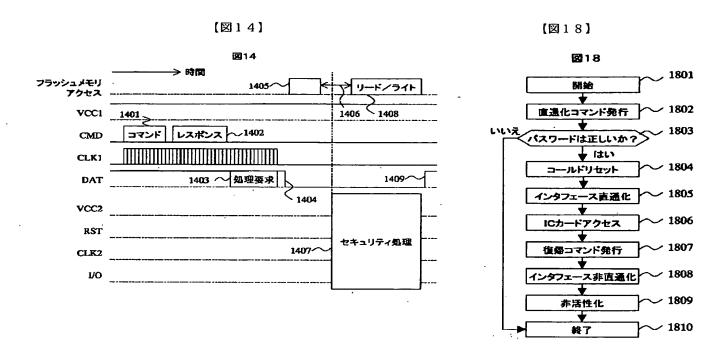


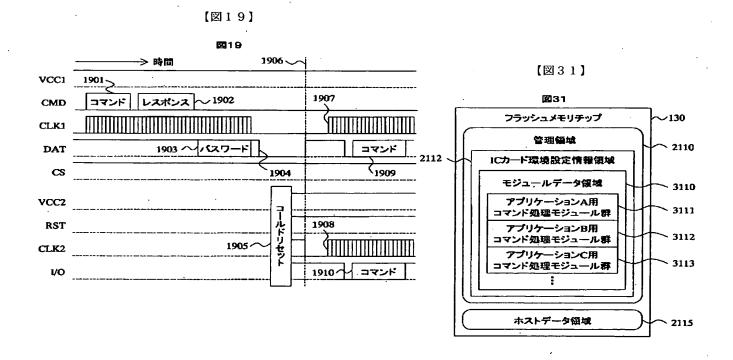
【図16】





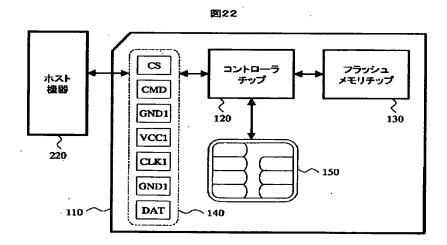






【図20】 【図32】 ⊠32 図20 → 時間 **2003** アプリケーションA用 ~3111 コマンド処理モジュール群 VCC1 2001 ~ 2002 番号 コマンド処理モジュール コマンド レスポンス コマンド CMD 第1PIN検証処理モジュール 3201 CLK1 ||| 2006/ 2 署名検証処理モジュール 3202 ~2005 DAT 3 乱数発生処理モジュール 3203 4 暗号化処理モジュール cs 3204 5 復号・比較処理モジュール **3205** 2004 VCC2 6 第2PIN検証処理モジュール > 3206 非活性化 暑名作成処理モジュール **RST** ~ 3207 CLK2 ||||||||| 1/0

【図22】

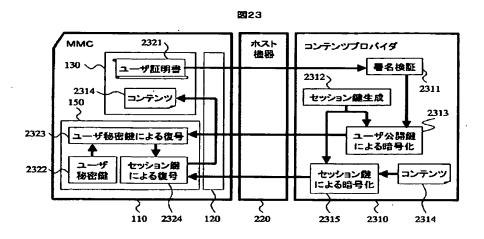


【図37】

図37

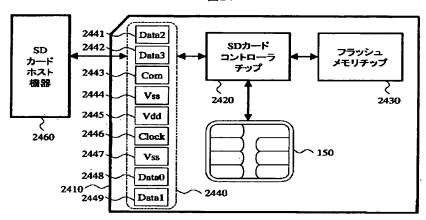
	鍵の名前	説明
3701	モジュール鍵	コマンド処理モジュールにかけられた暗号を解き、 実行可能な形式へ復元するための対称鍵。
3702~	アプリケーション秘密鍵	アプリケーション発行者が厳重に管理すべき秘密機。 コマンド処理モジュール更新時に使用。
3703 🔷	アプリケーション公開鍵	アプリケーション秘密量に対応する公開鍵。 ICカードチップ内の各アプリケーションが保持。 コマンド処理モジュールロード時、および コマンド処理モジュール更新時に使用。

【図23】



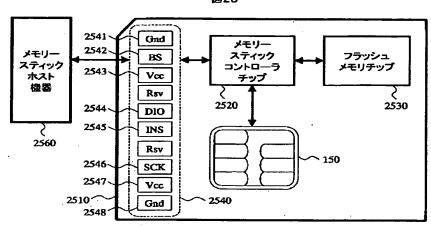
【図24】

図24

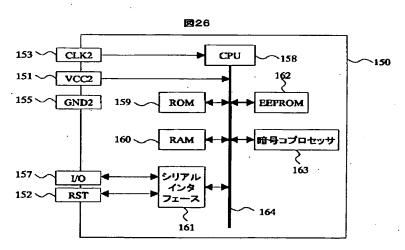


【図25】

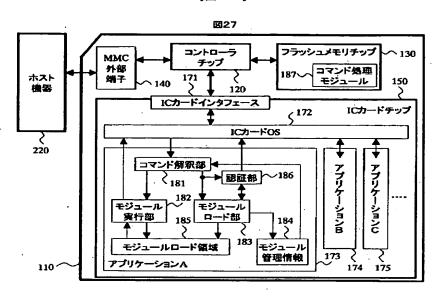
图25



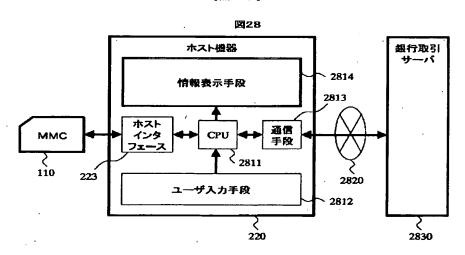
【図26】



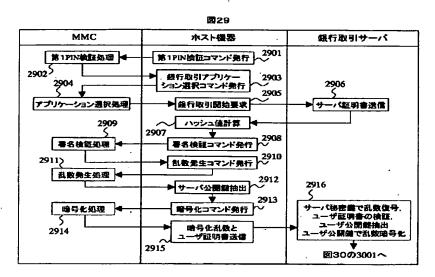
【図27】



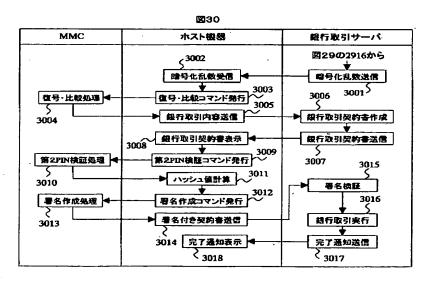
【図28】



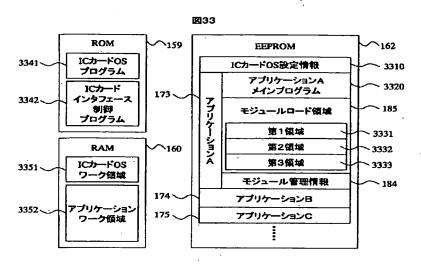
【図29】



【図30】

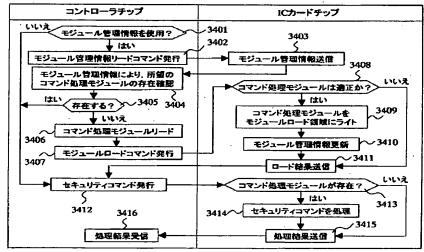


【図33】

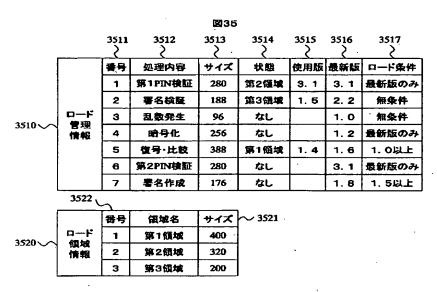


【図34】

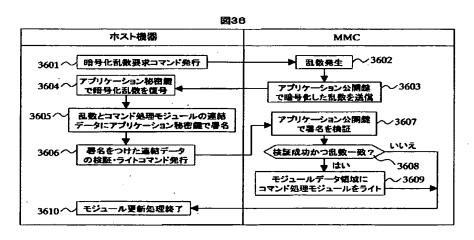
図34



【図35】

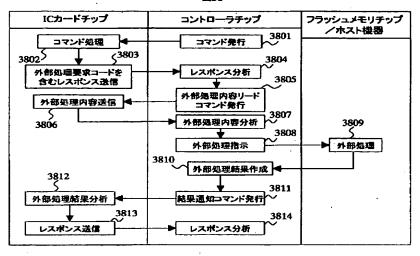


【図36】



【図38】

図38



30

フロントページの続き

(72) 発明者 幡野 富久

神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株 式会社日立製作所システム開発研究所内

(72) 発明者 片山 国弘 東京都小平市上水本町五丁目20番1号 株

式会社日立製作所半導体グループ内

(72) 発明者 田中 紀夫

神奈川県川崎市幸区鹿島田890番地 株式 会社日立製作所金融システム事業部内

(72) 発明者 常広 隆司

神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株

式会社日立製作所システム開発研究所内

(72) 発明者 木村 光一

神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株

式会社日立製作所システム開発研究所内

Fターム(参考) 2C005 MA04 MB01 MB08 MB10 NA02

NA40 NB01 NB04 SA02 SA03

SA11 SA22

5B035 AA06 AA13 BB09 BC00 CA11

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.